

日揚科技股份有限公司 HIGHLIGHT TECH CORP.



113年度年報

刊印日期：中華民國114年4月8日
公司網址：<https://www.htcvacuum.com>
年報查詢網址：<https://mops.twse.com.tw>

發言人

姓名：江慶偉

職稱：集團財務長

聯絡電話：(03)597-3325

電子郵件信箱：willson@high-light.com.tw

代理發言人

姓名：羅筱秋

職稱：特別助理

聯絡電話：(03)597-3325

電子郵件信箱：emma.luo@high-light.com.tw

總公司、分公司、工廠之地址及電話

總公司：台南市新市區活水路 8 號 (06)246-0296

新竹營運中心：新竹縣湖口鄉光復路 32 號 (03)597-3325

台中辦公室：台中市大雅區中科路 958 號 (04)256-06357

股票過戶機構

名稱：國票綜合證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市松山區南京東路五段 188 號 15 樓

網址：<https://www.ibfs.com.tw>

電話：(02)2528-8988

最近年度財務報告簽證會計師

會計師姓名：林永智、于智帆會計師

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所

地址：台北市信義區基隆路一段 333 號 27 樓

網址：<https://www.pwc.tw>

電話：(02)2729-6666

海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無。

公司網址：<https://www.htcvacuum.com>

目 錄

壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	6
二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金	13
三、公司治理運作情形	17
四、簽證會計師公費資訊	39
五、更換會計師資訊	40
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業資訊	40
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形	41
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊	42
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例	42
參、募資情形	
一、資本及股份	43
二、公司債辦理情形	46
三、特別股辦理情形	46
四、海外存託憑證辦理情形	46
五、員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形	46
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	46
七、資金運用計畫執行情形	46
肆、營運概況	
一、業務內容	47
二、市場及產銷概況	57
三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率	63
四、環保支出資訊	63
五、勞資關係	64

六、資通安全管理	65
七、重要契約	68

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況	69
二、財務績效	69
三、現金流量	70
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	70
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫	70
六、風險管理分析評估	71
七、其他重要事項	76

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料	77
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	77
三、其他必要補充說明事項	77
四、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第 36 條第 3 項第 2 款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項	77

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

感謝各位股東長期對本公司的關注、支持、愛護與指導，在此謹將 113 年營業結果、114 年營業計畫概要、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響，向各位股東報告：

一、113 年度營業結果

(一)營業計畫實施成果

本公司 113 年合併營收為新台幣(以下同)3,934,267 千元，較 112 年減少 271,169 千元，減少幅度為 6%。營業毛利為 1,359,804 千元，毛利率為 35%，較 112 年減少 77,737 千元，減少幅度為 5%。稅後淨利為 385,874 千元，較 112 年減少 8%。稅後基本每股盈餘 (EPS) 為 3.01 元，較 112 年 3.02 元減少 0.01 元。

(二)預算執行情形

單位：新台幣千元

項目	113 年度 實際	113 年度 預算	增(減)金額	達成率(%)
營業收入淨額	3,934,267	4,658,407	(724,140)	84%
營業毛利	1,359,804	1,644,544	(284,740)	83%
營業淨利	454,276	608,435	(154,159)	75%
營業外收入及支出	(5,384)	(47,801)	42,417	11%
稅前淨利	448,892	560,634	(111,742)	80%
所得稅費用	63,018	109,229	(46,211)	58%
本年度淨利	385,874	451,404	(65,530)	85%

(三)財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣千元

項目	113 年度	112 年度	增(減)金額	變動比率 (%)
營業收入淨額	3,934,267	4,205,436	(271,169)	(6%)
營業淨利	454,276	550,775	(96,499)	(18%)
營業外收入及支出	(5,384)	(27,139)	21,755	80%
稅前淨利	448,892	523,636	(74,744)	(14%)
所得稅費用	63,018	105,409	(42,391)	(40%)
本年度淨利	385,874	418,227	(32,353)	(8%)

項目	113 年度	112 年度
資產報酬率 (%)	6	6
股東權益報酬率 (%)	11	12
稅前純益占實收資本額比率 (%)	47	44
純益率 (%)	10	10
每股盈餘 (元)	3.01	3.02

(四)研究發展狀況

半導體市場競爭激烈，技術挑戰不斷升級，「創新研究發展中心」專注於整合半導體 Fab 與 Sub-fab 需求，結合集團內跨部門技術與人力資源，推動創新發展，將強化品牌價值和市場定位，以確保在全球半導體產業中保持領先的競爭優勢。

1. 主要技術與應用領域：

發展核心技術：閥門、系統控制整合、機電整合、韌體開發。

拓展技術領域：半導體製程優化、檢測平台、Sub-fab 解決方案、Pump 轉子術。

2. 解決方案與技術開發流程：

提供適切的技術解決方案，進行模擬測試與客戶驗證，確保技術落實，深入了解市場需求，掌握前沿技術，持續擴展技術領域。

3. 市場分析與發展策略：

透過系統化分析市場需求，制定年度目標與發展計畫，以專案管理方式平衡研發創新與客戶關係維護，確保技術開發具備可追溯性，提供未來優化依據。

二、114 年度營業計畫概要

(一)經營方針

本公司以人才培育、創新文化、卓越管理及專業服務為基礎，推動商業模式轉型，提升產業定位與產品價值。主要策略如下：

1. 發展半導體設備整合性服務與部件平台。
2. 強化第三類半導體設備及材料供應鏈。

(二)預期銷售數量及其依據

因本公司並未主動發布財務預測資訊，故不提供相關預測數據。

(三)重要產銷政策

銷售政策

1. 海外市場全球拓展計畫

(1) 重點市場的開拓

目標區域：美國、日本、新加坡、馬來西亞。

策略規劃：

- 與當地代理商及商社合作，進行產品介紹、售後服務及展會推廣活動，提升品牌市佔率。
- 在北美及歐洲地區將擴大代理商及經銷商激勵措施，開拓新客戶資源，擴充營收。

A. 日本市場

- a. 於熊本設置營業及維修據點 (114 年 2 月完工)，深化在地化服務並進一步拓展日本半導體市場。
- b. 提供競爭力成本及即時服務，增強客戶信賴。

B. 新馬市場

- a. 接洽半導體代工前三大客戶，推廣自有品牌 WEH® Coating 和永續節能加熱帶。
- b. 整合當地服務商資源，提升銷售規模及市場滲透率。

- C. 美國市場
 - a. 依託現有業務通路及工程合作夥伴，開發設備商為主要目標客群，預計 2025 年小量產，2026 年營收顯著增長。
 - b. 獲取維修認證，推廣 WEH® Coating，提升 CIP 產品收入。
- (2) 自有品牌市佔率及品牌推廣
 - A. 市場推廣重點
 - a. 強化 Htc 品牌在建廠與工程案的滲透率，特別是在新加坡與馬來西亞。
 - b. 委託專業公關公司，通過網站、媒體及展會提升品牌知名度，進入一線半導體廠供應鏈。
 - B. 設備商營收增長
 - a. 針對美國與日本 Tier 1 設備商，持續開發真空閥門及腔體相關產品，擴展日揚品牌影響力。
 - C. 網路行銷與推廣
 - a. 關鍵字廣告投放與優化，提高新客戶成交率及品牌曝光度。
 - D. 新產品布局與推廣
 - a. 鋁合金焊接腔體：應對量子科技市場需求。
 - b. 全金屬閘閥：滿足超高真空需求應用。
 - c. 快關閘閥：提升 Fab 廠應用實績。
 - d. WEH® Coating & ESG 加熱帶：主打永續效益，提供市場導入服務。
 - e. 國際展覽參與：曝光新產品並吸引潛在客戶。
- 2. 提高國內產業市佔率
 - (1) 提供完整解決方案的銷售服務
 - A. 聚焦半導體、國際設備大廠等，提供 Chamber、Valve 及新產品 WEH® Coating 整合式服務。
 - B. 強化真空產業價值鏈，進一步進行設備管路設計與改良。
 - (2) 與系統商及工程公司合作
 - A. 協同接單，針對半導體市場需求，拓展新產品應用場域。
 - (3) 代理/經銷商品
 - A. 3M 載帶：服務封裝產業並開發新應用。
 - B. 抗凍劑：因應歐盟法規更迭，完成新經銷合約並進入測試階段。
- 3. 新產品與服務推展
 - (1) 環保與節能技術應用
 - 將臭氧技術與潔淨設備結合，減少化學品使用及廢氣排放。
 - (2) 高附加值服務
 - 提供半導體及光電廠零件清洗、電漿噴塗及耗材製作。
 - (3) 高階設備市場推進
 - 推廣 XRT/SAM 晶圓檢測設備及臭氧水晶圓清洗技術，拓展相關市場需求。

生產政策

1. 管理系統

- (1) 組織管理：適材適用，專職專精，提升工作效率，減少作業錯誤。
- (2) 教育訓練：利用數位教學及模擬平台，實現快速、統一、高效的員工訓練，節省成本。
- (3) 知識管理：建立系統化的知識管理平台，支持知識儲存、分享與應用。

2. 生產力提升

(1) CIP 持續改善

引入精實生產理念，運用 ECRS 手法優化流程，減少浪費，提升效率。

(2) 自動化生產

推動自動化設備導入，降低成本，提高產能。

(3) 生產現場管理

引入管理系統，改善搬運車動線，增設儲位燈號，提升周轉效率。

(4) 技術應用

使用軌道焊接機，評估協作機器人，提升焊接作業的精度與效率。

(5) 人員培訓

定期進行交叉訓練，打造多能工以增強彈性支援能力。

3. 品質控制

- (1) 品質為本：堅持國際標準，確保產品滿足客戶需求。
- (2) 持續改進：使用失效模式分析和統計製程控制，定期審查風險並提出預防方案。
- (3) 全員參與：落實線上自主檢驗制度，減少不良品率，確保生產環節嚴謹性。

4. 成本管控

精準分析：透過料件、工時及費用結構分析，採取節約用料、提升效率、避免重工等措施，實現全面成本管控。

5. 生產形式

彈性應對需求：根據產品線特性採取混合生產模式。

項目	ETO 接單設計	MTO 接單生產	ATO 接單裝配	MTS 庫存生產
真空Parts		50%		50%
真空模組		100%		
真空閥門	15%	10%	55%	20%
真空腔體	15%	75%		10%

6. 導入產品管理系統 (PLM)

(1) 數位轉型與整合

與 ERP 系統結合，優化生產流程，實現降本增效目標。

(2) 核心功能

圖文管理：實現文件與料號的全檢索與資料聯繫。

料件管理：精準控管庫存與版本，確保資源利用最佳化。

設計變更：將附件、BOM 與圖檔緊密關聯，提升變更效率。

專案管理：系統化通知與追蹤，顯著提升專案執行績效。

三、未來公司發展策略

技術升級：針對真空閥門等高可靠性產品，深化市場應用場域。

客戶關係：融入主要客戶供應鏈，提供訂製化產品與改善專案。

永續經營：落實ESG目標，開發節能環保解決方案，提升產品與服務價值。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

1. 全球經濟

113 年趨勢：亂中有序，經濟成長緩慢；地緣政治（烏俄戰爭、以巴衝突）及區域經濟疲軟（歐洲、日本、中國）持續影響全球。

挑戰：供應鏈壓力、高利率、通膨及需求集中導致產能負荷不均。

2. 臺灣經濟

113 年 AI 與新興科技應用帶動出口，實質 GDP 前三季增長 5.19%，全年預估 4.23%，經濟穩健復甦，景氣持續正向發展。

應對策略：開拓海外市場，平衡產能，透過 VMI 及庫存管理提升效率。

3. 法規遵循與風險管控

出口管制確實遵守美國工業與安全局（BIS）對臺灣廠商的最新規定。

對有疑義的產品專案，申請經濟部書面鑑定，確保合規性。

4. 產業挑戰與策略

挑戰：半導體與 AI 市場快速變遷，競爭激烈，技術創新與服務品質成關鍵。

策略：整合市場需求與客戶反饋，提升產品適用性與價值，擴大資訊收集，進行靈活應對與專業評估。

5. 114 年展望

美國政策與中國經濟不確定性影響貿易復甦，電子產品需求回溫，AI 應用擴展，臺灣經濟成長率預估約 3%，整體審慎樂觀。

最後，敬祝各位股東

身體健康、萬事如意

董事長：吳昇憲



貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一) 董事資料

114 年 4 月 8 日；單位：股、%

職稱 (註 1)	國籍或 註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期	初次選 任日期	選 任 時 持有股份		現 在 持有股數		配偶、未成年子 女現在持有股份		利用他人名義持 有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務	具配偶或二親等以內關 係之其他主管或董事			備註 (註 2)
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職稱	姓名	關係	
董 事 長	中 華 民 國	昇大實業 有限公司	--	113.6.7	3 年	95.6.28	6,540,728	5.53	5,450,582	5.76	0	-	0	-	元智大學 機械工程碩士	日揚科技(股)公司行政長 明遠精密科技(股)公司董事(法人代表) 日揚電子科技(上海)有限公司監事 Htc真空株式會社董事長(法人代表) 實密科技(股)公司董事長(法人代表) 夏諾科技(股)公司董事長(法人代表) 利梭貿易(股)公司董事長(法人代表) 兆合科技(股)公司董事長(法人代表) 昇大實業有限公司董事長 德揚科技(股)公司監察人 瑞統科技(股)公司監察人	董事	吳明田	父子	無
		代表人 吳昇憲	男 60 歲 以下						1,923,192	2.03	176,674	0.19	5,450,582	5.76						
董 事	中 華 民 國	昇大實業 有限公司	--	113.6.7	3 年	95.6.28	6,540,728	5.53	5,450,582	5.76	0	-	0	-	光華商職	日揚科技國際(股)公司董事(法人代表) 日揚電子科技(上海)有限公司執行董事 寶德科技(股)公司獨立董事及薪酬委員 瑞統科技(股)公司董事長(法人代表) 宇柏林(股)公司董事	董事長 行政長	吳昇憲	父子	無
		代表人 吳明田	男 71 歲 以上						5,180,482	5.48	0	-	0	-						
董 事	中 華 民 國	匯弘(股) 公司	--	113.6.7	3 年	113.6.7	400,000	0.34	320,000	0.34	0	-	0	-	台北市立 士林高商	明遠精密科技(股)公司董事 全國加油站(股)公司董事長 滙豐柏油(股)公司董事長 盛豐化學建材(股)公司董事	無	無	無	無
		代表人 賴正時	男 71 歲 以上						0	-	0	-	0	-						
董 事	中 華 民 國	沈品秀	女 61 ~ 70 歲	113.6.7	3 年	107.6.8	3,662,489	3.10	2,659,991	2.81	0	-	0	-	淡江大學 企業管理學系	無	無	無	無	無

114 年 4 月 8 日；單位：股、%

職稱 (註 1)	國籍或 註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期	初次選 任日期	選 任 時 持有股份		現 在 持有股數		配偶、未成年子 女現在持有股份		利用他人名義持 有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務	具配偶或二親等以內關 係之其他主管或董事			備註 (註 2)
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
董事	中華 民國	羅浚胆	男 60 歲 以下	113.6.7	3 年	107.6.8	2,183,911	1.85	1,747,128	1.85	485,377	0.51	0	-	台灣大學醫學士 台灣大學法學士 醫師高考合格	晉倫科技(股)公司董事 卡洛生物醫藥(股)公司董事長 眾律國際法律事務所顧問	無	無	無	無
董事	中華 民國	凱揚資本 (股)公司	--	113.6.7	3 年	113.6.7	1,080,000	0.91	864,000	0.91	0	-	0	-	中興大學 合作經濟系	明遠精密科技(股)公司董事(法人代表) 柏承科技(股)公司獨立董事 新復興微波通訊(股)公司獨立董事 晶瑞光電(股)公司董事 凱揚資本(股)公司董事長 鼎碩資本投資(股)公司董事長	無	無	無	無
		代表人 黃俊育	男 61~ 70 歲						416,000	0.44	0	-	1,440,000	1.52						
董事	中華 民國	吳吉祥	男 61~ 70 歲	113.6.7	3 年	98.6.16	1,228,548	1.04	990,838	1.05	160,000	0.17	0	-	中國文化大學 經濟學系	無	無	無	無	無
董事	中華 民國	馬堅勇	男 61~ 70 歲	113.6.7	3 年	100.6.24	52,716	0.05	42,172	0.04	0	-	0	-	德國斯圖嘉特大 學冶金博士	台灣精材(股)公司董事長 中美矽晶製品(股)公司獨立董事 均豪精密工業(股)公司獨立董事 宏捷科技(股)公司獨立董事 合一特用材料(股)公司董事長 新矜能源科技(股)公司董事 易發精機(股)公司董事	無	無	無	無
獨立 董事	中華 民國	黃永昌	男 71 歲 以上	113.6.7	3 年	110.7.23	8,000	0.01	12,000	0.01	0	-	0	-	淡江大學 企業管理學系	大東紡織(股)公司董事(法人代表) 大東紡織(股)公司顧問兼董事長特助 永煌教育基金會董事長 大鐘印染(股)公司監察人(法人代表) 佛教僧伽醫護基金會財務顧問	無	無	無	無
獨立 董事	中華 民國	薛銘鴻	男 60 歲 以下	113.6.7	3 年	107.6.8	36,592	0.03	29,273	0.03	0	-	0	-	輔仁大學 法律碩士 律師高考及格	昭信法律事務所所長(執業律師) 景泓企業(股)公司董事	無	無	無	無
獨立 董事	中華 民國	賴懷頤	男 60 歲 以下	113.6.7	3 年	107.6.8	10,456	0.01	8,364	0.01	1,600	0.00	0	-	台北大學 會計碩士 會計師高考及格	賴懷頤會計師事務所所長(執業會計師)	無	無	無	無

註 1：法人股東之主要股東請詳下表一。

註 2：本公司董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)非為同一人、配偶或一親等親屬。

表一：法人股東之主要股東

114 年 4 月 8 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東及持股比率	
昇大實業有限公司	吳 昇 憲	58.9%
	吳 佳 瑩	12.5%
	吳 敏 杏	12.5%
	吳 佳 柔	12.5%
	王 維 伶	3.6%
匯弘(股)公司	賴 智 弘	40.0%
	賴 佩 瑀	20.0%
	賴 巧 恩	20.0%
	賴 以 恩	20.0%
凱揚資本(股)公司	許 淑 惠	34.5%
	黃 威 凱	27.6%
	黃 威 揚	27.6%
	黃 俊 育	10.3%

表二：表一主要股東為法人者其主要股東：不適用。

1. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名	條件 專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形 (註 2)	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
昇大實業有限公司代表人： 吳昇憲	1.未有公司法第 30 條各款情事。 2.現任董事長，並兼任子公司董事長及本公司行政長，歷練研發單位及業務單位，具備產業知識、經營管理、國際市場觀之能力，協調各部門運作、資源整合及分配，並持續建置完善管理制度及成本控制。	不適用	0
昇大實業有限公司代表人： 吳明田	1.未有公司法第 30 條各款情事。 2.本公司前任董事長，並有擔任其它公開發行公司董事及獨立董事之經驗，具備產業關係連結、領導決策、溝通協調、財務分析、營運判斷、危機處理之能力，監督公司持續發展及拓展業務。	不適用	1
匯弘(股)公司代表人： 賴正時	1.未有公司法第 30 條各款情事。 2.現任全國加油站(股)公司董事長，具有豐富產業知識及經營管理經驗，具備領導統御、溝通協調、風險管理、產業分析與市場布局能力，有卓越洞察力及判斷力，並享有高度聲望之人士。	不適用	0
沈品秀	1.未有公司法第 30 條各款情事。 2.歷任本公司監察人及董事多年，熟稔公司營運模式，對本公司營運指導及貢獻良多，為女性董事，能適時提供經營與管理之多元意見，在經營管理策略之思維上能更具多元化之面向。	不適用	0
羅浚鉅	1.未有公司法第 30 條各款情事。 2.具備法學與醫學專業知識，現任法律事務所顧問、臨床執業醫師及醫療生技產業經理人；透過跨領域之技能整合，協助產業管理與新創發展。近來積極推動 ESG，具備決策判斷、溝通協調、策略分析能力，並深具國際觀察與社會洞察力，提供公司產業布局及策略發展建議，保持產業競爭優勢。	不適用	0

條件 姓名	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形 (註 2)	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
凱揚資本(股) 公司代表人： 黃俊育	1.未有公司法第 30 條各款情事。 2.現任鼎碩資本投資(股)公司董事長，並有擔任其它公開發行公司董事及獨立董事之經驗，具備會計及財務分析、營運判斷、經營管理、產業知識，並歷任本公司監察人及董事多年，熟稔公司營運模式，提供專業及建設性的意見，提升營運價值並盡監督之責。	不適用	2
吳吉祥	1.未有公司法第 30 條各款情事。 2.曾任公開發行公司獨立董事之豐富經驗，歷任本公司多屆董事且兼任子公司之董事，熟稔公司運作，具備產業分析、財務分析，對產業發展及投資決策有豐富的經驗。	不適用	0
馬堅勇	1.未有公司法第 30 條各款情事。 2.現任台灣精材董事長，並有擔任其它公開發行公司董事及獨立董事之經驗，主要經歷光洋應材董事長及執行長、探微科技總經理、中科院材料光電所組長，具有豐富產業知識及經營管理經驗，具備領導決策、策略擘劃、危機處理及國際市場觀，並有專業技術專長且能深度瞭解產業脈動。	不適用	3
黃永昌	1.未有公司法第 30 條各款情事。 2.專業財務專長：擔任財務金融業之高階經理人及董事，具備豐富財務之產業實務經驗。 3.主要工作經歷： (1)元大商業銀行資深副總經理 (2)元大國際租賃(股)公司董事 (3)元大國際人身保險代理人(股)公司董事 (4)元大財產保險代理有限公司董事 (5)慶銀資產管理(股)公司董事長 (6)財團法人佛教僧伽醫護基金會董事/財務顧問 (7)國泰世華銀行法金部資深業務協理 (8)世華銀行經理	左列三位獨立董事皆符合金融監督管理委員會頒訂之證券交易法第十四條之二暨「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」(註 3)相關規定。	0
薛銘鴻	1.未有公司法第 30 條各款情事。 2.專業法律專長：律師高考及格，具備專業且豐富的法律實務經驗(執業律師)。 3.主要工作經歷： (1)昭信法律事務所所長(執業律師) (2)中華民國律師公會全國聯合會刑事程序法委員會委員 (3)台北市選舉委員會委員 (4)台北律師公會裁判實務研究委員會主委 (5)輔仁大學法律系講師	左列三位獨立董事皆符合金融監督管理委員會頒訂之證券交易法第十四條之二暨「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」(註 3)相關規定。	0
賴憬頤	1.未有公司法第 30 條各款情事。 2.專業會計專長：會計師高考及格，具備專業且豐富的會計師實務經驗(執業會計師)。 3.主要工作經歷： (1)賴憬頤會計師事務所所長(執業會計師) (2)賴明福會計師事務所會計師 (3)國立空中大學推廣教育中心講師 (4)醒吾科技大學推廣教育中心講師 (5)景文科技學大財稅系講師	左列三位獨立董事皆符合金融監督管理委員會頒訂之證券交易法第十四條之二暨「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」(註 3)相關規定。	0

註 1：專業資格與經驗：敘明個別董事之專業資格與經驗，如屬審計委員會成員且具備會計或財務專長者，應敘明其會計或財務背景及工作經歷，另說明是否未有公司法第 30 條各款情事。

註 2：獨立董事應敘明符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人；最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

註 3：1. 非公司法第二十七條規定以政府、法人或其代表人當選。

2. 選任前二年及任職期間無「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條第 1 項 1-9 款之各項情事。(本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重，詳董事資料之持有股份)

3. 兼任其他公開發行公司獨立董事未逾三家。

2. 董事會多元化及獨立性：

(1) 董事會多元化

A. 多元化政策：

本公司已訂定「公司治理實務守則」，於第 20 條明定董事會成員多元化方針。董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採候選人提名制，並依「董事選舉法」及「公司治理實務守則」辦理，以確保董事成員之多元化與獨立性。

B. 依多元化政策擬訂具體多元化管理目標：

a. 兼任公司經理人之董事 < 1/3。

b. 尊重性別平等：董事會成員至少 1 席女性董事。

c. 專業知識與技能：董事會包括法律、財務會計及產業經驗之專業知識與技能。

C. 第 11 屆董事會由 11 位董事組成，多元化情形：

董事姓名	性別	兼任本公司員工	年齡			獨董任期年資		專門職業	專業知識與技能						
			60歲以下	61—70歲	71歲以上	4—6年	7—9年		製造相關	財務會計	燃料能源	資訊科技	法律	醫療	營建
吳昇憲	男	✓	✓						✓						
吳明田	男				✓				✓						
賴正時	男				✓						✓				
沈品秀	女			✓											✓
羅浚叵	男		✓					醫師					✓	✓	
黃俊育	男			✓						✓					
吳吉祥	男			✓						✓					
馬堅勇	男			✓					✓		✓				
黃永昌 (獨立董事)	男				✓	✓				✓					
薛銘鴻 (獨立董事)	男		✓				✓	律師					✓		
賴憬頤 (獨立董事)	男		✓				✓	會計師		✓		✓			

多元化情形：

- a. 兼任本公司員工之董事為 1 位，占比為 9%，低於董事席次 1/3。(符合管理目標)
 - b. 性別組成多元化，1 位女性董事，占比為 9%。(符合管理目標)
 - c. 年齡分布多元化，董事會成員年 60 歲以下 4 位(36.4%)、61~70 歲 4 位(36.4%)、71 歲以上 3 位 (27.2%)。
 - d. 獨立董事任期皆未超過三屆，其中有 1 位年資 4~6 年、2 位年資 7~9 年。
 - e. 專業知識與技能多元化，董事會成員之專業背景包括法律、會計、財務金融、機械加工及製造、電子材料、燃料能源、醫療、營建、管理等各類領域實務專家所組成，故董事會成員均具備執行職務所必須之知識及技能，並具備多元之產業經驗。(符合管理目標)
 - f. 董事會成員有多元化之專業能力及產業經驗，整體董事會具備營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。
- D. 董事會任一性別董事席次未達 1/3 之原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施：
- a. 原因：
本公司所屬產業多以男性專業人才居多，女性於該產業內比例相對較低。此外，現任董事會成員任期仍在進行中，短期內較難立即調整董事性別比例。
 - b. 規劃提升董事性別多元化採行之措施：
俟董事會屆滿進行改選前，尋求多方管道之專業人才，以利落實董事成員性別多元化政策。

(2) 董事會獨立性

董事會成員共有 11 位，含 3 位獨立董事，占比為 27%；董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係，亦無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項規定情事。

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門與分支機構主管資料

114 年 4 月 8 日；單位：股、%

職 稱	國籍	姓 名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任 其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註 (註)
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
集團執行長	中華民國	寇崇善	男	105.9.1	167,478	0.18	0	-	0	-	美國加州大學 洛杉磯分校 電機工程博士	明遠精密科技(股)公司董事長兼策略長 明遠精密科技(上海)有限公司董事長(法人代表) 立盈電子科技(上海)有限公司董事長(法人代表) 立盈科技國際有限公司董事長(法人代表) 德揚科技(股)公司董事(法人代表) フィネステクノロジー株式会社董事(法人代表)	無	無	無	無
集團行政長	中華民國	吳昇憲	男	113.9.1	1,923,192	2.03	176,674	0.19	5,450,582	5.76	元智大學 機械工程碩士	日揚科技(股)公司董事長(法人代表) 明遠精密科技(股)公司董事(法人代表) 日揚電子科技(上海)有限公司監事 Htc 真空株式会社董事長(法人代表) 實密科技(股)公司董事長(法人代表) 夏諾科技(股)公司董事長(法人代表) 利梭貿易(股)公司董事長(法人代表) 兆合科技(股)公司董事長(法人代表) 昇大實業有限公司董事長 德揚科技(股)公司監察人 瑞統科技(股)公司監察人	無	無	無	無
集團財務長	中華民國	江慶偉	男	112.9.1	10,000	0.01	0	-	0	-	台北大學 會計碩士	實密科技(股)公司監察人 兆合科技(股)公司監察人	無	無	無	無
集團技術長	中華民國	葉文勇	男	113.1.1	0	-	0	-	0	-	清華大學 材料科學工程博士	無	無	無	無	無
集團執行副總	中華民國	張伯昌	男	113.9.1	0	-	0	-	0	-	台灣海洋大學 機械系	實密科技(股)公司總經理	無	無	無	無
集團副總暨 市場開發總經理	中華民國	許原華	男	114.1.1	4,000	0.00	0	-	0	-	台灣大學 醫學工程碩士	兆合科技(股)公司董事 夏諾科技(股)公司總經理	無	無	無	無
真空製造總經理	中華民國	王衍聖	男	110.1.1	38,340	0.04	16	0.00	0	-	成功大學 機械工程碩士	無	無	無	無	無
系統整合總經理	中華民國	賴文成	男	113.9.1	0	-	0	-	0	-	交通大學 科技管理碩士	無	無	無	無	無
日揚電子科技 (上海)有限公司 總經理	中華民國	王志紘	男	110.1.1	11,747	0.01	0	-	0	-	中興大學 農業機械系	無	無	無	無	無
副總經理	中華民國	楊鴻津	男	100.2.1	208,000	0.22	0	-	0	-	中原大學 企業管理學系	無	無	無	無	無
業務副總經理	中華民國	黃揮仁	男	114.1.1	0	-	0	-	0	-	東海大學 會計學系	無	無	無	無	無

註：總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長非為同一人、配偶或一親等親屬。

二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

(一) 一般董事及獨立董事之酬金

單位：新台幣千元

職 稱	姓 名	董事酬金								A、B、 C 及 D 等四項總額及占 稅後純益之比例 (%)		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、 E、F 及 G 等七 項總額及占稅後 純益之比例(%)		領取來自子 公司以外轉 投資事業或 母公司酬金
		報酬 (A)		退職退休金 (B)		董事酬勞 (C)		業務執行費用 (D)				薪資、獎金及 特支費等(E)		退職退休金 (F)		員工酬勞 (G)						
		本公司	財務報 告內所有公司	本公司	財務報 告內所有公司	本公司	財務報 告內所有公司	本公司	財務報 告內所有公司	本公司	財務報 告內所有公司	本公司	財務報 告內所有公司	本公司	財務報 告內所有公司	本公司		財務報告內 所有公司		本公司	財務報 告內所有公司	
董 事 長	昇大實業有限公司 代表人：吳昇憲	3,336	3,756	-	-	5,961	7,085	230	335	9,527 2.95%	11,176 3.46%	2,760	3,149	108	108	1,721	-	1,721	-	14,116 4.37%	16,154 5.00%	18
董 事	昇大實業有限公司 代表人：吳明田																					
董 事	匯弘(股)公司 代表人：賴正時																					
董 事	沈品秀																					
董 事	羅浚鉅																					
董 事	凱揚資本(股)公司 代表人：黃俊育																					
董 事	吳吉祥	360	360	-	-	2,236	2,236	165	165	2,761 0.85%	2,761 0.85%	-	-	-	-	-	-	-	-	2,761 0.85%	2,761 0.85%	-
董 事	馬堅勇																					
獨立董事	黃永昌																					
獨立董事	薛銘鴻																					
獨立董事	賴憬頤																					

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：

(1)本公司訂有「董事會績效評估管理辦法」，制定評分項目及比重等，每年依據執行情形得出評分，並提送董事會及功能性委員會。

(2)董事及獨立董事之報酬，授權董事會參酌國內外業界通常支給水平議定，並衡量公司經營規模及營運情況調整之。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董 事 姓 名			
	前四項酬金總額 (A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告 內所有公司	本公司	財務報告 內所有公司
低於 1,000,000 元	吳吉祥、馬堅勇、 匯弘(股)公司代表人_ 賴正時、凱揚資本(股) 公司代表人_黃俊育、 沈品秀、羅浚詎、薛銘 鴻、賴憬頤、黃永昌	吳吉祥、馬堅勇、 沈品秀、羅浚詎、 薛銘鴻、賴憬頤、 黃永昌	吳吉祥、馬堅勇、 匯弘(股)公司代表人_ 賴正時、凱揚資本(股) 公司代表人_黃俊育、 沈品秀、羅浚詎、薛銘 鴻、賴憬頤、黃永昌	吳吉祥、馬堅勇、 沈品秀、羅浚詎、 薛銘鴻、賴憬頤、 黃永昌
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	昇大實業有限公司 _吳明田	昇大實業有限公司_吳 明田、匯弘(股)公司代 表人_賴正時、凱揚資 本(股)公司代表人_黃 俊育	昇大實業有限公司 _吳明田	匯弘(股)公司代表人_ 賴正時、凱揚資本(股) 公司代表人_黃俊育
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	昇大實業有限公司 _吳昇憲	昇大實業有限公司 _吳昇憲	—	昇大實業有限公司 _吳明田
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	—	—	—	—
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	—	—	昇大實業有限公司 _吳昇憲	昇大實業有限公司 _吳昇憲
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	—	—	—	—
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	—	—	—	—
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	—	—	—	—
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	—	—	—	—
100,000,000 元以上	—	—	—	—
總計	11	11	11	11

(二) 總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣千元

職稱	姓 名	薪資(A)		退職退休金 (B)		獎金及特支費 等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、 C 及 D 等四項總 額及占稅後純益之比例(%)		領取來自 子公司以 外轉投資 事業或母 公司酬金
		本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司		財務報告內 所有公司		本公司	財務報告內 所有公司	
								現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額			
集團執行長	寇崇善	33,121	35,854	827	827	7,973	9,072	15,800	-	16,225	-	57,721 17.85%	61,978 19.17%	33
集團行政長	吳昇憲													
集團財務長	江慶偉													
集團技術長	葉文勇													
集團執行副總	張伯昌													
集團副總暨市場開 發總經理	許原華													
真空製造總經理	王衍聖													
系統整合總經理	賴文成													
日揚電子科技(上 海)有限公司總經理	王志紘													
副總經理	楊鴻津													

註：葉文勇 113.1.1 新任、賴文成 113.9.1 新任；黃揮仁 114.1.1 新任（未列於上表）

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理 酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	—	—
1,000,000 元(含) ~ 2,000,000 元(不含)	楊鴻津	楊鴻津
2,000,000 元(含) ~ 3,500,000 元(不含)	葉文勇、王志紘	葉文勇
3,500,000 元(含) ~ 5,000,000 元(不含)	吳昇憲、賴文成、江慶偉	吳昇憲、賴文成、江慶偉、王志紘
5,000,000 元(含) ~ 10,000,000 元(不含)	許原華、張伯昌、王衍聖	許原華、張伯昌、王衍聖
10,000,000 元(含) ~ 15,000,000 元(不含)	—	—
15,000,000 元(含) ~ 30,000,000 元(不含)	寇崇善	寇崇善
30,000,000 元(含) ~ 50,000,000 元(不含)	—	—
50,000,000 元(含) ~ 100,000,000 元(不含)	—	—
100,000,000 元以上	—	—
總計	10	10

註：葉文勇 113.1.1 新任、賴文成 113.9.1 新任；黃揮仁 114.1.1 新任（未列於上表）

(三) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

114 年 4 月 8 日；單位：新台幣千元

職稱		姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經 理 人	集團執行長	寇崇善	0	15,800	15,800	4.89
	集團行政長	吳昇憲				
	集團財務長	江慶偉				
	集團技術長	葉文勇				
	集團執行副總	張伯昌				
	集團副總暨市場開發總經理	許原華				
	真空製造總經理	王衍聖				
	系統整合總經理	賴文成				
	日揚電子科技(上海)有限公司總經理	王志紘				
	副總經理	楊鴻津				

註：截至年報刊印日止，113 年度員工酬勞名單尚未決定，故暫依去年度實際配發金額比例計算今年擬議分派數，113 年度員工酬勞分派係經董事會通過擬議分派現金新臺幣 40,985 千元。

(四) 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性

1. 最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析

單位：新台幣千元

年度 職稱	112 年度				113 年度			
	本 公 司		合 併 報 表		本 公 司		合 併 報 表	
	酬金	占稅後純益比例	酬金	占稅後純益比例	酬金	占稅後純益比例	酬金	占稅後純益比例
董 事	15,464	4.33%	16,825	4.71%	12,288	3.80%	13,937	4.31%
總經理及 副總經理	42,919	12.02%	46,848	13.12%	57,721	17.85%	61,978	19.17%

註：上述董事酬金包含報酬、退職退休金、董事酬勞及業務執行費用；總經理及副總經理之酬金包含薪資、退職退休金、獎金及特支費、員工酬勞金額。

2.給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性

(1)給付酬金之政策、標準與組合

A.本公司於 113/8/9 訂定「董事及經理人薪資酬勞辦法」，董事酬金包括報酬、酬勞及業務執行費用：①報酬依本公司章程第 18 條規定，董事長及董事之報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常之水準議定之；②酬勞依本公司章程第 31 條規定，本公司年度如有獲利，由董事會決議提撥不高於 2%為董事酬勞；③業務執行費用包括車馬費及各種津貼。

B.本公司經理人及員工之報酬依據「薪資管理辦法」相關規定支給，其中經理人酬金，依本公司章程第 29 條明訂，其委任、解任及報酬依照公司法第 29 條規定辦理，並依規定由薪資報酬委員會評估及訂定，並提董事會決議。

給付酬金之組合，包括固定薪資及績效酬勞，其中績效酬勞分為季績效獎金（依營運目標達成率計算）、年終獎金（依獲利目標達成率計算）及員工酬勞（依章程第 31 條規定，本公司年度如有獲利，應提撥 10~15%為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放）。

(2)訂定酬金之程序

本公司董事及經理人之報酬訂定及酬勞分配依章程辦理，並依規定經薪資報酬委員會及董事會討論。

本公司依「董事會績效評估辦法」定期進行董事績效評估，將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。董事成員績效評估項目包括「公司目標與任務之掌握」、「董事職責認知」、「對公司營運之參與程度」、「內部關係經營與溝通」、「董事之專業及持續進修」及「內部控制」等六項構面，薪酬委員會於 114/1/6 規劃 113 年度董事績效評估指標（個別評估指標包括：了解策略性目標、產業之特性及風險、遵守保密義務、會前已閱讀及瞭解會議資料、對公司經營團隊及所屬產業瞭解、與經營團隊的互動、與簽證會計師溝通、具備決策執行所需的專業、有持續強化其專業知識與技能、對公司財會及稽核報告監督等 10 項指標），於 114/3/3 討論評估結果，並提 114/3/4 董事會報告，個別評核結果皆達優良則均分酬勞。

本公司定期每年討論專業經理人之績效考核，由董事會評估項目為：財務績效、市場績效及非量化績效指標（包括策略規劃、新市場開發、產品研發及人才培育等），定期每年交評估績效報告予薪資報酬委員會及董事會參考，經薪資報酬委員會評估後，並提董事會決議通過後辦理。

(3)與經營績效及未來風險之關聯性

本公司董事及經理人酬金政策相關給付標準及制度檢討，除了參考業界薪酬水準外，並以公司整體營運狀況為主要考量。本公司經營階層之重要決策，均衡酌各種風險因素後為之，相關決策之績效即反應於公司之獲利情形，其薪酬與風險之控管績效相關。本公司另依職等擬定員工持股信託方案（每月自員工薪資提撥自提金，本公司也提撥同等金額的公司獎勵金），除獎勵員工以低成本投資公司股票外，更鼓勵員工長期累積存股、儲備退休資產，其實際價值與未來股價相關，與公司共同承擔未來經營風險。

三、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形

113 年度董事會開會 6 次 (A) · 董事出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率 (%) (B/A)	備註
董 事 長 (第 11 屆董事長)	昇大實業有限公司 代表人：吳昇憲	6	0	100%	連任, 113/6/7 改選 (法人代表人當選董事)
董 事 (第 10 屆董事長)	昇大實業有限公司 代表人：吳明田	6	0	100%	連任, 113/6/7 改選 (法人代表人當選董事)
董 事	匯弘(股)公司 代表人：賴正時	6	0	100%	連任, 113/6/7 改選 (法人代表人當選董事)
董 事	沈品秀	5	1	83%	連任, 113/6/7 改選
董 事	羅浚詎	6	0	100%	連任, 113/6/7 改選
董 事	凱揚資本(股)公司 代表人：黃俊育	6	0	100%	連任, 113/6/7 改選 (法人代表人當選董事)
董 事	吳吉祥	5	1	83%	連任, 113/6/7 改選
董 事	馬堅勇	5	1	83%	連任, 113/6/7 改選
獨 立 董 事	黃永昌	6	0	100%	連任, 113/6/7 改選
獨 立 董 事	薛銘鴻	6	0	100%	連任, 113/6/7 改選
獨 立 董 事	賴憬頤	6	0	100%	連任, 113/6/7 改選

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(一) 證券交易法第 14 條之 3 所列事項：不適用。

(二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形：

董事會日期 (期別)	議案內容	迴避董事 姓名	應利益迴避原因	參與表決情形
113/3/8 (第 10 屆第 18 次)	解除新任董事競業禁止之 限制案	吳明田 吳昇憲 羅浚詎 黃俊育 賴正時 馬堅勇 黃永昌	本案當事人	當事人個別迴避， 不參與討論及表決 (本案提 113/6/7 股東常會決議)
113/6/7 (第 11 屆第 1 次)	薪資報酬委員會成員 委任案	黃永昌 薛銘鴻 賴憬頤	本案當事人	不參與討論及表決
	永續發展委員會成員 委任案	黃永昌 薛銘鴻 賴憬頤 吳昇憲	本案當事人	不參與討論及表決

董事會日期 (期別)	議案內容	迴避董事 姓名	應利益迴避原因	參與表決情形
113/8/9 (第 11 屆第 2 次)	向關係人取得不動產使用 權資產追認案	吳昇憲 吳明田	本案關係人(擔任夏諾 董事長職務)及一親等	不參與討論及表決
	董事長報酬擬訂案	吳昇憲 吳明田	本案當事人及一親等	不參與討論及表決
	本公司與子公司明遠精密 科技股份有限公司簽定「技 術合作開發合約」追認案	吳昇憲 黃俊育 賴正時 吳明田	本案關係人(擔任明遠 董事職務)及一親等	不參與討論及表決

三、董事會評鑑執行情形：評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊如下表。(註)

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

- (一) 本公司董事會之運作均依照法令規定行使職權，所有董事具備執行職務所必須之專業知識、技能及素養，本屆(第 11 屆)董事會結構中，董事成員具備多元之專業能力及經驗背景，審計委員會成員具備會計、財務及法律專業背景，有助於提升決策品質。
- (二) 本公司為建立良好董事會治理制度，參照主管機關所訂之公司治理指導原則，於 112/1/12 修正「公司治理實務守則」，持續健全公司治理運作。
- (三) 本公司於 111/8/4 制定「永續發展實務守則」，並於 113/6/7 設置隸屬董事會之「永續發展委員會」，於 111/11/10 制定「風險管理實務守則」，由審計委員會督導風險管理，公司內部成立「風險管理委員會」，透過委員會的運作，定期向審計委員會及董事會報告運作情形，以強化董事會監督職能。
- (四) 本公司於 113/1/11 辦理營運發展策略會議，由經營團隊向董事報告營運發展計畫，讓董事對策略發展有更充分的參與及討論。

(註) 董事會評鑑執行情形

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行 一次	113/1/1 至 113/12/31	整體董事會	內部自評 (董事長、功能性委員會 召集人執行評核)	一、對公司營運之參與程度。 二、提升董事會決策品質。 三、董事會組成與結構。 四、董事的選任及持續進修。 五、內部控制。
		個別董事成員	董事成員自評 (董事會成員執行評核)	一、公司目標與任務之掌握。 二、董事職責認知。 三、對公司營運之參與程度。 四、內部關係經營與溝通。 五、董事之專業及持續進修。 六、內部控制。
		審計委員會	內部自評 (獨立董事執行評核)	一、對公司營運之參與程度。 二、功能性委員會職責認知。 三、提升功能性委員會決策品質。 四、功能性委員會組成及成員選任。 五、內部控制。
		薪資報酬委員會	內部自評 (獨立董事執行評核)	一、對公司營運之參與程度。 二、功能性委員會職責認知。 三、提升功能性委員會決策品質。 四、功能性委員會組成及成員選任。
		永續發展委員會	內部自評 (董事長、獨立董事 執行評核)	一、對公司營運之參與程度。 二、功能性委員會職責認知。 三、提升功能性委員會決策品質。 四、功能性委員會組成及成員選任。

(二) 審計委員會運作情形

113 年度審計委員會開會 6 次 (A) , 獨立董事出席情形如下 :

職 稱	姓 名	實際出席 次數 (B)	委託出席 次數	實際出席率 (%)(B/A)	備註
召集人 (第 3 屆召集人)	黃永昌	6	0	100%	獨立董事 (連任, 113/6/7 改選)
委 員 (第 2 屆召集人)	薛銘鴻	6	0	100%	獨立董事 (連任, 113/6/7 改選)
委 員	賴憬頤	6	0	100%	獨立董事 (連任, 113/6/7 改選)

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

審計委員會 日期 (期別)	議案內容及後續處理	審計委員會 決議結果	公司對審計委員會 意見之處理
113/1/10 (第 2 屆第 17 次)	- 增加對日本子公司 Htc 真空株式會社投資案 - 應收帳款逾正常授信期限 3 個月仍未收回且金額重大者，非屬資金貸與性質評估案	全體出席委員同意通過	提第 10 屆第 17 次董事會，全體出席董事同意通過。
113/3/7 (第 2 屆第 18 次)	112 年度營業報告書及財務報表案 112 年度盈餘分派案 - 現金減資案 112 年度內部控制制度聲明書案 - 內部控制制度修正案 (銷售及收款循環) - 對子公司日本 Htc 真空株式會社銀行融資之背書保證案 - 變更簽證會計師暨會計師之獨立性、適任性及公費評估案	全體出席委員同意通過	提第 10 屆第 18 次董事會，全體出席董事同意通過。
	解除新任董事競業禁止之限制案	除利害關係人迴避不參與討論及決議外，其餘出席委員均同意通過	提第 10 屆第 18 次董事會，除利害關係董事個別迴避不參與討論及決議外，其餘出席董事均同意通過。
	預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業得向本公司及子公司非確信服務案	全體出席委員同意通過	依決議執行。
113/5/9 (第 2 屆第 19 次)	113 年第 1 季財務報表案 - 直接及間接投資利梭貿易有限公司案 - 應收帳款逾正常授信期限 3 個月仍未收回且金額重大者，非屬資金貸與性質評估案 - 審計委員會組織規程修正案 - 內部控制制度修正案	全體出席委員同意通過	提第 10 屆第 19 次董事會，全體出席董事同意通過。

審計委員會 日期 (期別)	議案內容及後續處理	審計委員會 決議結果	公司對審計委員會 意見之處理
113/8/8 (第 3 屆第 2 次)	113 年第 2 季財務報表案 113 年上半年盈餘分派案 - 應收帳款逾正常授信期限 3 個月仍未收回且金額重大者，非屬資金貸與性質評估案 - 為子公司日本 Htc 真空株式会社銀行融資之背書保證案	全體出席委員同意通過	提第 11 屆第 2 次董事會，全體出席董事同意通過。
	- 向關係人取得不動產使用權資產追認案 - 本公司與子公司明遠精密科技股份有限公司簽定「技術合作開發合約」追認案		除利害關係董事個別迴避不參與討論及決議外，其餘出席董事均同意通過。
113/11/7 (第 3 屆第 3 次)	113 年第 3 季財務報表案 - 為子公司背書保證案 - 內部控制制度訂定及修正案	全體出席委員同意通過	提第 11 屆第 3 次董事會，全體出席董事同意通過。

(二) 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形：無。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：

(一) 溝通政策：

1. 獨立董事與內部稽核主管至少每季單獨溝通，與會計師每年至少二次單獨溝通。
2. 稽核單位每月將稽核報告及查核缺失改善追蹤報告送交獨立董事，稽核主管並於每次定期董事會皆列席報告內部稽核業務情形。
3. 稽核主管及會計師與獨立董事若有議題討論，得視需要直接相互聯繫。

(二) 113 年度獨立董事與內部稽核主管及會計師之獨立溝通情形：

獨立董事與內部稽核主管單獨溝通 5 次；與會計師單獨溝通 3 次，溝通情形如下：

日期	會議	溝通對象	溝通事項	溝通結果
113/1/10	座談會(視訊)	稽核主管	112 年 10-11 月稽核業務執行情形	本次會議無意見
113/3/7	座談會(視訊)	稽核主管	112 年 12 月稽核業務執行情形 113 年 1 月稽核業務執行情形	本次會議無意見
113/3/7	座談會(視訊)	會計師	112 年度查核結論	本次會議無意見
113/5/9	座談會(視訊)	稽核主管	113 年 2-3 月稽核業務執行情形	本次會議無意見
113/5/9	座談會(視訊)	會計師	113 年第一季核閱完成與治理單位之溝通	本次會議無意見
113/8/8	座談會(視訊)	稽核主管	113 年 4-6 月稽核業務執行結果	本次會議無意見
113/11/7	座談會(視訊)	稽核主管	113 年 7-9 月稽核業務執行結果 114 年稽核計畫	本次會議無意見
113/11/7	座談會(視訊)	會計師	113 年第三季核閱完成與治理單位之溝通 113 年度查核規劃階段治理單位之溝通	本次會議無意見

(三) 公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		訂定於 110/11/11，修正於 112/1/12，經董事會通過，並揭露於公開資訊觀測站及公司網站。	無差異
二、公司股權結構及股東權益 (一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	✓		設有發言人、代理發言人、股務及法務人員負責處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟等事宜。	無差異
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	✓		由股務單位負責管理相關資訊，適時掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單。	無差異
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	✓		已建立內部控制制度及管理辦法控管與關係企業間之風險，各公司人員及財務管理權責均明確劃分。	無差異
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓		訂有「防範內線交易管制作業規範」，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券等違法獲利，並定期作內部教育訓練及宣導。	無差異
三、董事會之組成及職責 (一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	✓		已訂定董事會多元化政策，具體管理目標及落實執行，請細資訊參閱第 10~11 頁。	無差異
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	✓		董事會於 113/6/7 設置永續發展委員會，由董事長及 3 位獨立董事組成。	無差異
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	✓		訂定於 104/3/26，修正於 112/1/12，每年定期進行績效評估。113 年度績效評估結果於 114/3/4 提報董事會，以供評估個別董事薪酬及提名續任之參考。	無差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		每年定期評估證會計師之獨立性及適任性，參照審計品質指標 (AQIs) 擬訂評估會計師專業性、品質控管、獨立性、監督及創新能力等 5 大構面及 13 項 AQI 指標，並請簽證會計師及其事務所提供相關資料及聲明書。由會計部針對委任會計師之「獨立性評估表」及「適任性評估表」據以評估會計師獨立性及適任性。最近期評估於 114/3/3 經審計委員會及 114/3/4 董事會討論通過。(註)	無差異
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	✓		董事會於112/5/5通過設置公司治理主管，並配置適任及適當人數之公司治理人員，負責公司治理相關事務。	無差異
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	✓		本公司網站有設置利害關係人專區(https://www.htcvacuum.com/zh-tw/investor/index/ESG/stakeholder)，提供特定聯絡窗口及聯絡方式，以回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。	無差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司已委任「國票綜合證券股份有限公司股務代理部」之專業股務代辦機構辦理股東會相關事務。	無差異
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	✓		本公司已架設網站，揭露財務業務及公司治理等資訊。 (https://www.htcvacuum.com)	無差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？	✓		本公司已架設中英文網站，並指定專人負責公司網站維護及揭露資訊，由相關單位人員負責資訊之蒐集、落實發言人制度及將法人說明會資訊放置公司網站等。	無差異
(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？		✓	本公司財務報告依規定期限公告及申報。	尚無法提早公告財務報告。
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事購買責任保險之情形等)？	✓		(一)員工權益及僱員關懷：參閱本年報「勞資關係」。 (二)投資者關係：公司網站設有投資人專區提供投資人關心的各項資訊，並提供專責人員聯絡方式。 (三)供應商關係：依循 ISO9001、ISO14001、ISO45001 等國際標準管理系統，對於供應商遴選、評核、定期稽核皆有建立管理作業程序，其供應管理包含品質、商業道德、勞動權益、環境保護與職業安全衛生、技術及供應能力、無有害物質予以考量。 (四)利害關係人之權利：公司網站設有利害關係人專區，揭露所辨別之利害關係人身份、關注議題、溝通管道與回應方式，並每年定期發行永續報告書，揭露利害關係人所關切之重大主題相關資訊。 (五)董事進修之情形：董事進修時數皆符合規範，113 年每位董事進修 6 小時以上。	無差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			(六)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：由審計委員會督導風險管理，公司內部成立「風險管理委員會」，負責訂定風險管理政策，建立質化與量化之管理標準，透過委員會的運作，定期向審計委員會及董事會報告運作情形。執行情形參見公司網站。 (七)客戶政策之執行情形：依 ISO 管理系統及內部流程化管理機制，處理客訴案件，並針對客戶提出問題進行追蹤改善，每年定期進行客戶滿意度調查。 (八)公司為董事購買責任保險之情形：已於 107 年起為董事及重要職員購買責任保險。	
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。 (一) 112 年公司治理評鑑結果：本公司為上櫃公司組 6%至 20%，市值 50 億元以上至 100 億元類別 21%至 40%。 較一年度進步指標：全體董事親自出席股東常會、依法設置公司治理主管、由審計委員會督導風險管理、編製英文版永續報告書、揭露人權政策之具體管理方案、揭露職場多元化及性別平等執行情形、揭露過去兩年溫室氣體年排放量、用水量及廢棄物總重量。 (二) 113 年推動改善事項：設置永續發展委員會、召開二次法說會、揭露 TCFD 報告書、評估對社區之風險或機會並採行相應措施、永續報告書提董事會討論。				

(註)評估指標如下表，評估結果符合審計品質指標 (AQIs) 及本公司獨立性及適任性評估標準。

審計品質指標評估表

項目	AQI 指標	評估項目	評估結果
專業性			
1-1	查核經驗	資深查核人員是否具備足夠之審計經驗以執行查核工作。	是
1-2	訓練時數	會計師及資深查核人員每年是否接受足夠之教育訓練，以持續獲取專業知識及技能。	是
1-3	流動率	事務所是否維持足夠資深之人力資源。	是
1-4	專業支援	事務所是否擁有足夠之專業人員(例如評價人員)，以支援查核團隊。	是
品質控管			
2-1	會計師負荷	會計師工作負荷是否過重。	否
2-2	查核投入	查核團隊成員於各查核階段投入是否適當。	是
2-3	EQCR 複核情形	EQCR 會計師是否投入足夠之時數執行審計案件之複核。	是
2-4	品管支援能力	事務所是否具備足夠之品質控管人力，以支援查核團隊。	是
獨立性			
3-1	非審計服務公費	是否瞭解非審計服務公費占比對獨立性之影響。	是
3-2	客戶熟悉度	是否瞭解審計個案於事務所簽證年度財務報告之累計年數對獨立性之影響。	是
監督			
4-1	外部檢查缺失及處分	是否瞭解事務所之品質管制及審計個案是否依有關法令及準則執行。	是
4-2	主管機關發函改善	是否瞭解事務所之品質管制及審計個案是否依有關法令及準則執行。	是
創新能力			
5-1	創新規劃或倡議	是否瞭解會計師事務所提升審計品質之承諾，包括會計師事務所創新能力及規劃。	是

委任會計師獨立性評估表

項目	評估項目	評估結果
1	委任會計師與本公司間未有直接或重大間接財務利益關係。	是
2	委任會計師與本公司或本公司董事無融資或保證行為。	是
3	委任會計師本人、其配偶或受扶養親屬、其審計小組成員於審計期間或最近兩年內未擔任本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。	是
4	委任會計師無與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係。	是
5	委任會計師無對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目。	是
6	委任會計師無仲介本公司所發行之股票或其他證券。	是
7	除依法令許可之業務外，委任會計師未代表本公司與第三者間法律案件或其他爭議事項之辯護。	是

委任會計師適任性評估表

項目	評估項目	評估結果
1	具備豐富的專業資格及專業經歷。	是
2	最近二年未有受會計師懲戒委員會懲戒或金管會處分之記錄。	是
3	能及時提供財務及稅務簽證報告。	是
4	能提供稅務及證管法令更新的資訊及建議。	是

(四) 薪資報酬委員會運作情形

1. 薪資報酬委員會成員資料

114 年 4 月 8 日

身分別	姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司 薪資報酬委員會成員家數
獨立董事(召集人)	黃永昌	成員由三位獨立董事組成，其專業資格與經驗及獨立性情形參見第 9 頁。			0
獨立董事	薛銘鴻				0
獨立董事	賴憬頤				0

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2) 本屆委員任期：民國 113 年 6 月 7 日至 116 年 6 月 6 日，113 年度薪資報酬委員會開會 5 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率 (B/A)	備註
召集人(新任)	黃永昌	5	0	100%	連任, 113/6/7 改選
召集人(舊任)	薛銘鴻	5	0	100%	連任, 113/6/7 改選
委 員	賴憬頤	5	0	100%	連任, 113/6/7 改選

其他應記載事項：

本公司薪資報酬委員會 113 年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：

薪資報酬委員會 日期 (期別)	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬 委員會意見之處理
113/1/10 (第 5 屆第 10 次)	■ 薪資報酬委員會 113 年度工作計畫案	全體出席委員 同意通過	依決議執行。
	■ 112 年度董事會績效評估規劃案		提第 10 屆第 17 次董事會 報告，依規劃執行。
	■ 112 年度員工年終獎金發放計畫案		提第 10 屆第 17 次董事會， 全體出席董事同意通過。
113/3/7 (第 5 屆第 11 次)	■ 112 年度董事會績效評估結果案	全體出席委員 同意通過	提第 10 屆第 18 次董事會 報告結果。
	■ 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案		提第 10 屆第 18 次董事會， 全體出席董事同意通過。
113/5/9 (第 5 屆第 12 次)	■ 內部人之經理人適用範圍及管理規則 修正案 ■ 經理人薪酬調整案 ■ 執行長之績效評估及薪資獎酬案	全體出席委員 同意通過	提第 10 屆第 19 次董事會， 全體出席董事同意通過。
113/6/7 (第 6 屆第 1 次)	■ 薪資報酬委員會召集人推選案	全體出席委員 一致推選黃永 昌獨立董事擔 任召集人	依規定公告及申報。
113/8/8 (第 6 屆第 2 次)	■ 董事及經理人薪資酬勞辦法制訂案 ■ 執行長薪酬擬訂案 ■ 董事長報酬擬訂案	全體出席委員 同意通過	提第 11 屆第 2 次董事會， 全體出席董事同意通過。

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。

二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

(五) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

評估項目	執行情形 (註 1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	✓		(一) 董事會為永續發展最高治理機構，於 113/6/7 設置「永續發展委員會」(由董事長及 3 位獨董擔任委員)。公司內部成立「ESG 推動小組」，由執行長擔任主任委員，並指派相關人員擔任委員，負責推動環境、社會及治理之發展，以確保永續發展相關工作的推動與落實。 (二) 永續發展委員會秉於董事會之授權，忠實履行職權，定期(至少一年一次)向董事會報告 ESG 執行情形。(113 年永續發展委員會及 ESG 推動小組運作情形揭露於公司網站) (三) 董事會對永續發展之督導情形： 1. 永續報告書審查(113/8/9)。 2. 溫室氣體盤查計畫之執行進度(113/3/8、5/10、8/9、11/8)。 3. 風險管理及公司治理議題執行情形報告(113/11/8)。 4. 定期於每年 1 月安排經理人向董事會報告公司營運發展計畫(113/1/11)。	無差異
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？(註 2)	✓		(一) 依全球永續性報告協會 GRI 準則，揭露經濟、環境及社會面向的重大主題績效。除財務績效以合併財務報表為範疇外，其餘不含子公司活動，並以台灣地區為揭露範疇。 (二) 參考 GRI 準則所列的議題，並蒐集利害關係人關注之議題，依「利害關係人關心程度」和「對公司衝擊影響程度」，據以評估重大性之 ESG 議題，並訂定相關風險管理政策或機制。(註 3)	無差異
三、環境議題 (一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓		所有廠區均依循 ISO14001 建立環管系統及持續通過第三方驗證(有效期至 2025 年 4 月 9 日)。	無差異

評估項目	執行情形 (註 1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	✓		持續推動節能行動，並評估投資於節能或綠色能源相關環保永續之設備。(能源耗用及廢棄物處理量，詳參閱本公司永續報告書之「能源管理」及「廢棄物管理」內容)	無差異
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	✓		ESG 推動小組依 TCFD 架構評估氣候風險，透過風險矩陣，摘要列出短中長期氣候風險與機會議題，其評估結果及所採取相關之因應措施，於 113/12/12 第三次推動會議提出「113 年 TCFD 氣候風險評估報告」，經永續發展委員會討論後，提 114/1/7 提董事會報告。(詳參閱第 31~32 頁氣候相關資訊執行情形)	無差異
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	✓		於 111 年開始統計溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並將統計資料揭露於永續報告書。 112 年完成遷廠，以 113 年為基準，制定減量目標、推動措施，定期執行情形。113 年相關資料將揭露於 2024 年永續報告書。	無差異
四、社會議題				
(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	✓		公司依勞基法訂定工作規則，依循國際人權公約制定人權政策與管理方案。(詳細內容及執行情形揭露於公司網站)	無差異
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	✓		依勞基法訂定「工作規則」及「薪資管理辦法」，涵蓋薪酬、獎金、工時、休假等勞資權益。參考市場薪酬水準，確保薪資競爭力，依公司章程，年度獲利提撥 10~15%作為員工酬勞。(詳參閱年報「勞資關係」及公司網站)	無差異
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	✓		本公司已通過 ISO45001 職業安全衛生管理系統認證(有效期至 2025 年 4 月 24 日)，透過系統化的管理，推動各項管理方案，建置安全與健康工作環境： 1. 對員工安全與工作環境保護： (1) 定期 <u>每季</u> 召開職業安全衛生委員會。	無差異

評估項目	執行情形 (註 1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			(2) 定期<u>每月</u>查核工作場所缺失，並進行矯正改善及預防措施。 (3) 定期<u>每年</u>進行危害鑑別與風險評估，並針對意外事故再檢視，據此採取預防、改善與管理措施以降低風險。 (4) 各廠區每年辦理 2 次緊急應變與疏散演練，以提升應變能力。 (5) 新進人員到職當日進行職業安全教育訓練，入職後並每年定期舉辦健康促進講座及健康衛教宣導，以提升員工健康意識。 2.職業災害調查及統計： (1) 每年委外監測特別危害作業環境並進行健康檢查，113 年結果皆符合法規無異常。 (2) 113 年無重大職業傷害，發生 5 件通勤事故、1 件意外工傷。失能傷害頻率(FR)1.59、失能傷害嚴重率(SR)17。該工傷因吊掛作業未遵守標準程序，操作不慎導致物件掉落砸傷足部，損失日數 11 日。事故已檢討改善，並修訂作業規範、強化教育訓練與宣導，以防再發。 (3) 113 年無職業病案例。公司配有特約醫師與專職護理師，提供健康諮詢、衛教與講座。透過年度健檢、異常工作負荷預防計畫及每半年環境測定，醫護人員評估職業病風險並提供飲食、運動與醫療建議。針對年度健康檢查出現三高(即高血糖、高血脂、高血壓)等慢性疾病之員工，除安排專職護理師諮詢外，另擬定教材進行衛教宣導。 3.113 年無火災事件。每月進行自動消防檢查，每年定期查修，每半年消防演練，以防火災發生。	
(四) 公司是否為員工建立	✓		依職能需求提供內部培訓，並鼓勵員工自我提升參與外部課程。增補人力時，	無差異

評估項目	執行情形 (註 1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
有效之職涯能力發展培訓計畫？			員工可依興趣專長參加內部應試，主管則依專長與意願安排培訓或輪調，確保適才適所，發揮潛能。(詳參閱本公司永續報告書之「人才培育」)	
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	✓		本公司對於所提供之產品與服務遵循相關法規及國際準則，並依循 ISO 系統化管理流程，處理客戶問題，以保障客戶權益。	無差異
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	✓		已訂定供應商管理政策，並通過 ISO 9001、ISO 14001 和 ISO 45001 等標準管理系統認證，對供應商的遴選、評核和定期稽核建立完整的管理程序，其範疇涵蓋品質、商業道德、勞動權益、環境保護、安全衛生、技術與供應能力及無有害物質控管。另訂有「供應商企業社會責任行為準則作業規範」，並持續宣導，以確保供應商符合要求。(詳細內容及執行情形揭露於永續報告書及公司網站)	無差異
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	✓		(一) 本公司依循全球永續性報告組織之 GRI 準則(GRI Standards) 編製永續報告書，並依據 SASB 工業機械與物品行業指標進行揭露。 (二) 112 年永續報告書尚未取得第三方驗證，113 年永續報告書將辦理第三方確信，相關資訊將於 113 年永續報告書內揭露。	112 年永續報告書尚未取得第三方驗證； 113 年永續報告書將辦第三方確信。
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無差異。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：詳揭露於本公司網站及永續報告書。				

註 1：執行情形如勾選「是」，請具體說明所採行之重要政策、策略、措施及執行情形；執行情形如勾選「否」，請於「與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因」欄位解釋差異情形及原因，並說明未來採行相關政策、策略及措施之計畫。

註 2：重大性原則係指有關環境、社會及公司治理議題對公司投資人及其他利害關係人產生重大影響者。

註 3：ESG 風險管理政策或機制

重大議題	風險評估項目	管理政策/管理機制
環境永續	溫室氣體	- 制定盤查計畫，並按季向董事會提報執行情形 - 依盤查情形制定管理目標及改善計畫
	能源管理	規劃導入節能電盤系統，監控數據並改善耗能
	環境管理	通過 ISO 14001 環境管理系統驗證 (揭露於公司網站)
社會責任	職業健康與安全	- 通過 ISO 45001 職業安全衛生管理系統驗證(揭露於公司網站) - 每年定期消防演練及工安教育訓練 - 定期每季職業安全衛生委員會 - 人權政策及管理方案 (揭露於公司網站)
	薪資福利	- 薪酬管理委員會定期檢討薪酬制度 - 職工福利委員會檢討福利措施
	客戶隱私	- 保密協議及機密資料管理機制 - 明訂資訊安全政策 (揭露於公司網站)
	供應商管理	明訂供應商管理政策 (揭露於公司網站)
公司治理	營運績效	- 每月檢討營運績效 - 董事會定期提報營業成果
	誠信經營	- 誠信經營守則明訂誠信政策 (揭露於公司網站) - 制定誠信經營作業程序及行為指南 (揭露於公司網站) - 明訂檢舉辦法 (吹哨者制度) (揭露於公司網站)
	風險管理	風險管理實務守則明訂風險管理政策 (揭露於公司網站)

氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
一、敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	(一) 董事會為因應氣候變遷之最高權責單位，負責督導氣候變遷相關議題及事項。另為強化董事會對因應氣候變遷等永續事項之監督職責，於 113/6/7 設置「永續發展委員會」，負責審議永續發展政策、策略及管理方針，並監督推動永續發展相關事項及執行方案。 (二) 在管理層級方面，本公司設置「ESG 推動小組」，由執行長擔任主任委員，負責本公司永續發展策略擬訂及執行監督；轄下依推動主要項目設置督導主管，推動公司各項永續工作，並定期向董事會報告公司 ESG 執行情形。 (三) 在工作小組方面，依環境保護、社會責任、公司治理分設推動小組，其中環境保護推動小組，負責蒐集、評估氣候變遷相關資訊，據以擬訂因應氣候變遷方案、定期檢討改善，並落實執行節能減排等氣候相關業務。 (四) 113 年執行情形： - 溫室氣體盤查執行進度定期每季向董事會報告。 - ESG 執行情形定期每年(至少一年一次)向董事會報告。 - 永續發展委員會召開 2 次會議。 - ESG 推動小組召開 3 次會議。

項目	執行情形										
二、敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	本公司參考 TCFD 指引，建立氣候相關風險管理程序。由環境永續小組進行資訊蒐集，並鑑別評估營運策略上所面臨氣候相關風險、找出短中長期的潛在危機與機會，確保重大氣候風險均被有效控制在風險胃納範圍內。 (詳參閱本公司 2024 TCFD 報告之「2.1 鑑別流程」)										
三、敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	依「預估面臨時間」與「財務衝擊程度」將風險分類出低中高三個等級，並產生矩陣圖列出本公司重大氣候風險與機會。 (詳參閱本公司 2024 TCFD 報告之「2.2 氣候風險與機會」)										
四、敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度	透過 ESG 推動小組及相關單位共同合作，研擬相關因應措施與控管機制，進行策略性管理。並透過定期會議檢視監控成效，確保各項風險管理方針貼合法規與外部趨勢進行。 (詳參閱本公司 2024 TCFD 報告之「2.1 鑑別流程」)										
五、若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	(一) 本公司參考聯合國政府間氣候變遷專門委員會(IPCC) 發布的第六次評估報告 (AR6-2021)進行氣候模擬推估碳升溫模擬，透過美國氣候中心 (Climate Central) 進行海平面上升模擬，以不同溫升情境，模擬海平面上升狀況，以推估本公司各廠區可能面對之氣候風險，評估長期性實體風險。假設在 RCP8.5(高排放)情境模擬淹水發生之機率變化趨勢，評估是否有立即性實體風險。參考土壤液化中度潛勢區評估間接風險，透過世界資源研究所的水風險地圖集(Aqueduct water risk atlas)推估乾旱或缺水風險。 (詳參閱本公司 2024 TCFD 報告之「2.3 氣候情境分析」) (二) 主要財務影響尚未具體評估。										
六、若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	(一) 本公司因應管理氣候相關風險之轉型風險及實體風險，依風險層面、等級/面臨時間、主要風險因素，擬定風險管理方案。 (詳參閱本公司 2024 TCFD 報告之「3. 氣候機會行動」) (二) 評估各項風險管理方案，並依國際趨勢，擬定指標及目標。										
七、若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	本公司尚未使用內部碳定價。										
八、若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	(一) 為達到全球長期目標，各國提出「國家自定貢獻」(NDCs)，向國際展現溫室氣體減量承諾，每五年更新以提升減碳企圖心。本公司參考我國 NDCs 淨排放量之減量目標，訂定出短中長期計畫： <table><tr><td>減碳目標</td><td>2024 年</td><td>短期:2027 年</td><td>中期:2030 年</td><td>長期:2050 年</td></tr><tr><td>碳密度</td><td>基準年</td><td>減少 10%</td><td>減少 20%</td><td>碳中和</td></tr></table> (詳參閱本公司 2024 TCFD 報告之「4.指標與目標」) (二) 本公司尚未使用碳抵換或再生能源憑證。	減碳目標	2024 年	短期:2027 年	中期:2030 年	長期:2050 年	碳密度	基準年	減少 10%	減少 20%	碳中和
減碳目標	2024 年	短期:2027 年	中期:2030 年	長期:2050 年							
碳密度	基準年	減少 10%	減少 20%	碳中和							
九、溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫。	(一) 溫室氣體盤查及確信情形將依公開發行公司年報應行記載事項準則第 10 條第 2 項規定之令所定之時程辦理。 (二) 113 年溫室氣體盤查資訊將於永續報告書揭露。										

(六) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案				
(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	✓		本公司經營理念以「誠信」為首，以「事實」為最重要的核心價值，強調去除表面，做最有價值的事。本公司參照「上市上櫃公司誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，制定本公司誠信經營政策，並於 111/11/10 經董事會通過，明示誠信經營之政策、作法，並揭露於公司網站。董事會與高階管理階層落實誠信經營政策之承諾，並於內部管理及商業活動中確實執行。	無差異
(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	✓		本公司「誠信經營守則」依據「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高違反誠信行為風險之營業活動，訂定防範違反誠信行為方案，並建立有效之會計制度及內部控制制度，透過稽核室定期查核，確認制度執行情形及檢討制度有效性。	無差異
(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	✓		已訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，明定防範違反誠信行為方案之作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，經查違反屬實者，依公司規定給予懲處，並定期檢討修正前揭方案。	無差異
二、落實誠信經營				
(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	✓		本公司已評估往來對象之誠信紀錄，簽訂之契約中明訂誠信行為條款，如涉及違反誠信行為，本公司得隨時終止或解除契約之條款。	無差異
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報	✓		本公司於 111/11/10 董事會通過，由風險管理委員會之「誠信風險小組」為推動企業誠信經營之專責單位，定期(至少一年一次)向董事會報告，並於公	無差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 誠信經營守則差 異情形及原因
	是	否	摘要說明	
告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？			司網站揭露執行情形。113 年執行情形摘要(詳細內容揭露於公司網站)： 1. 修訂制度： 依法規修正制度，並符合實務作業，確保誠信經營相關措施適當。 2. 教育宣導： 安排相關專題，向董事、經理人或相關人員進行教育訓練宣導。 3. 事件統計： 113 年無違反誠信相關事件。	
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	✓		本公司於「誠信經營守則」明定利益迴避條款，禁止提供或收受不正當利益，並制定「誠信經營作業序及行為指南」，規範相關利害衝突處理程序及違反誠信行為之檢舉制度。	無差異
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	✓		本公司重視財務報導的正確性與完整性，針對高風險不誠信行為，建立有效之會計制度及內部控制制度。內部稽核依風險評估擬定年度稽核計畫執行查核，並向董事會及管理層報告結果與改善方案，以確保稽核成效。透過年度內控自評，檢視內部控制制度的設計與執行效能。	無差異
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		每年定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練，113 年執行情形： 1. 內部員工訓練：113 年 3~8 月，由法務主管對內部 256 名員工進行「員工權利與義務」及「營業秘密」教育宣導 (2 小時/次)。 2. 高階治理課程：113/8/9 安排 9 名董事與 3 名高階經理人參加中華公司治理協會開辦之「經營權爭議與案例分析」課程 (共 3 小時)。 3. 文件宣導：113 年 1、4、7 月對董事及經理人(共 20 人)宣導持股異動申報之相關函文，遵循證交法規範。	無差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 誠信經營守則差 異情形及原因
	是	否	摘要說明	
三、公司檢舉制度之運作情形 (一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	✓		本公司「檢舉辦法」公開揭示於公司網站，明定具體檢舉及獎勵制度，於公司網站公告獨立檢舉信箱及專線，供本公司內部及外部人員使用。凡發現違反誠信經營，可透過下列管道進行舉報： 1.審計委員會信箱： hueh7155@ms27.hinet.net 2.檢舉信箱： shine@high-light.com.tw 3.檢舉專線：(03)597-3325 分機 3188 4.以書面舉報，郵寄資訊： 收件地址:新竹縣湖口鄉光復路 32 號 受理單位:行政管理中心	無差異
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	✓		前項辦法明確規範檢舉處理程序、調查完成後應採取之後續措施及對相關人員的保密措施。	無差異
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	✓		本公司對檢舉人身分及檢舉內容應予保密，並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。	無差異
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	✓		本公司將「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」揭露於公開資訊觀測站與公司網站。每年定期向董事會報告推動成效，並揭露於公司網站。	無差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形) (一) 本公司以遵守法規為落實誠信經營之基礎。 (二) 本公司之誠信經營守則訂立於 100/10/28、第一次修正於 104/6/25、第二次修正於 109/2/24、第三次修正於 111/11/10。				

(七) 其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊

- 1.本公司適時安排董事會成員及經理人參與公司治理課程、研討會或論壇，以提升監督及治理能力。
- 2.本公司已連續三年編製永續報告書，並於公司網站公開揭露及提供電子檔下載。
(<https://www.htcvacuum.com/zh-tw/investor/index/ESG/sustainability-report>)

(八) 內部控制制度執行狀況應揭露下列事項

1.內部控制聲明書：

日揚科技股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：114年03月04日

本公司民國 113 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國113年12月31日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國114年03月04日董事會通過，出席董事11人中，有0人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

日揚科技股份有限公司

董事長：吳昇憲

簽章

執行長：寇崇善

簽章

2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(九) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

1.中華民國 113 年 6 月 7 日股東會重要決議如下：

會議日期	重要決議事項	執行情形檢討
113/6/7	通過承認 112 年度營業報告書及財務報表案	承認 112 年之營業報告書及財務報表。
	通過承認 112 年度盈餘分派案	考量營運規劃及資本結構調整，決議不配發股利。
	通過現金減資案	訂定 113/7/19 為減資基準日，113/9/27 為減資換股基準日，現金減資退還股款於 113/10/7 發放。
	通過董事(含獨立董事)改選案	依股東會決議，於 113/6/27 經濟部核准變更登記。
	通過解除新任董事競業禁止之限制案	依股東會決議，於 113/6/7 至公開資訊觀測站辦理重大訊息公告。

2.董事會重要決議如下：

日期 (屆次)	決議事項
113/1/11 (第 10 屆第 17 次)	通過 一、 113 年度營運計畫及營業預算案 二、 增加對日本子公司 Htc 真空株式會社投資案 三、 金融機構授信額度案 四、 應收帳款逾正常授信期限 3 個月仍未收回且金額重大者，非屬資金貸與性質評估案 五、 112 年度員工年終獎金發放計畫案
113/3/8 (第 10 屆第 18 次)	通過 一、 112 年度營業報告書及財務報表案 二、 112 年度盈餘分派案 三、 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案 四、 現金減資案 五、 董事(含獨立董事)改選案 六、 董事會提名董事(含獨立董事)候選人名單暨資格審查案 七、 解除新任董事競業禁止之限制案 八、 113 年股東常會召開事宜案 九、 112 年度內部控制制度聲明書案 十、 內部控制制度修正案 十一、 對子公司日本 Htc 真空株式會社銀行融資之背書保證案 十二、 向金融機構洽訂授信額度案 十三、 變更簽證會計師暨會計師之獨立性、適任性及公費評估案
113/5/10 (第 10 屆第 19 次)	通過 一、 113 年第 1 季財務報表案 二、 投資利梭貿易有限公司案 三、 應收帳款逾正常授信期限 3 個月仍未收回且金額重大者，非屬資金貸與性質評估案 四、 董事會議事規範修正案 五、 審計委員會組織規程修正案 六、 內部控制制度修正案 七、 內部人之經理人適用範圍及管理規則修正案 八、 經理人薪酬調整案 九、 執行長之績效評估及薪資獎酬案

日期 (屆次)	決議事項
113/6/7 (第 11 屆第 1 次)	通過 一、 董事長推選案 二、 永續發展委員會設置暨永續發展委員會組織規程修正案 三、 薪資報酬委員會成員委任案 四、 永續發展委員會成員委任案
113/8/9 (第 11 屆第 2 次)	通過 一、 113 年第 2 季財務報表案 二、 113 年上半年盈餘分派案 三、 應收帳款逾正常授信期限 3 個月仍未收回且金額重大者，非屬資金貸與性質評估案 四、 為子公司日本 Htc 真空株式会社銀行融資之背書保證案 五、 擬訂金融機構授信額度案 六、 112 年度永續報告書審議案 七、 董事及經理人薪資酬勞辦法制訂案 八、 向關係人取得不動產使用權資產追認案 九、 董事長報酬擬訂案 十、 執行長薪酬擬訂案 十一、 本公司與子公司明遠精密科技股份有限公司簽定「技術合作開發合約」追認案
113/11/8 (第 11 屆第 3 次)	通過 一、 113 年第 3 季財務報表案 二、 擬訂金融機構授信額度案 三、 為子公司背書保證案 四、 114 年度內部稽核計畫案 五、 內部控制制度訂定及修正案 六、 稽核報告簽署授權案
114/1/7 (第 11 屆第 4 次)	通過 一、 114 年度營運計畫及營業預算案 二、 投資設立子公司兆合科技股份有限公司案 三、 為子公司日本 Htc 真空株式会社銀行融資之背書保證案 四、 擬訂金融機構授信額度案 五、 內控制度修正案 六、 基層員工範圍評估案 七、 永續發展政策及目標規劃案 八、 113 年度員工年終獎金發放計畫案 九、 解除董事競業禁止之限制案 十、 與子公司明遠精密科技股份有限公司簽定技術合作開發合約案
114/3/4 (第 11 屆第 5 次)	通過 一、 113 年度營業報告書及財務報表案 二、 113 年度盈餘分派表案 三、 資本公積發放現金案 四、 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案 五、 公司章程修正案 六、 114 年股東常會召開案 七、 113 年度內部控制制度聲明書案 八、 內部控制制度修正案 九、 為子公司兆合科技股份有限公司之背書保證案 十、 金融機構授信額度案 十一、 簽證會計師之獨立性、適任性及公費評估案
114/4/8 (第 11 屆第 6 次)	通過 一、 解除董事競業禁止之限制案 二、 114 年股東常會召集事由增列案

(十)最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：

董事會 日期(屆次)	重要決議事項及決議情形
113/8/9 (第 11 屆第 2 次)	第十一案 案由：本公司與子公司明遠精密科技股份有限公司簽定「技術合作開發合約」追認案。 決議：除迴避此案之董事外，經主席徵詢其餘出席董事意見，二席（羅浚鉅董事、沈品秀董事）表示保留意見，三席同意，本案經出席董事過半數同意通過。

四、簽證會計師公費資訊

金額單位：新臺幣千元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師 查核期間	審計 公費	非審計 公費	合計	備註
資誠聯合會計師事務所	林永智 于智帆	113/01/01~ 113/12/31	3,200	270	3,470	非審計公費包含移轉訂價、直扣法稅務作業等

(一)更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：

金額單位：新臺幣千元

112 年度	113 年度	增減變動金額
3,785	3,470	(315)
增減原因：因應公司未來營運發展及內部管理需要，於 113 年第 1 季重新遴選簽證會計師，經審計委員會及董事會通過，改委任資誠聯合會計師事務所查核簽證，審計公費變動係與事務所依規定程序議價之結果。		

(二)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者：無此情形。

五、更換會計師資訊

(一)關於前任會計師：

更換日期	民國 113 年 3 月 8 日董事會通過		
更換原因及說明	公司未來營運發展及內部管理需要		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人	會計師	委任人
	情 況		
	主動終止委任		
	不再接受(繼續)委任		V
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無此情形		
與發行人有無不同意見	有		會計原則或實務
			財務報告之揭露
			查核範圍或步驟
			其他
	無	V	
	說明		
其他揭露事項 (本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無此情形		

(二)關於繼任會計師：

事務所名稱	資誠聯合會計師事務所
會計師姓名	林永智、于智帆
委任之日期	民國 113 年 3 月 8 日提報董事會通過，自 113 年第 1 季起委由繼任會計師簽證。
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無此情形
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無此情形

(三)前任會計師對本準則第 10 條第 6 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函：無。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業：無此情形。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

(一)董事、經理人及大股東股權變動情形

單位：股

職稱	姓名	113 年度(註 2)		114 年截至 4 月 8 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長	昇大實業有限公司	(930,146)	無	0	無
	代表人：吳昇憲	(480,799)	無	0	無
董事	昇大實業有限公司	-	-	-	-
	代表人：吳明田	(1,450,555)	無	25,000	無
董事	匯弘(股)公司	(80,000)	無	0	無
	賴正時	0	無	0	無
董事	沈品秀	(890,498)	無	(112,000)	無
董事	羅浚叵	(436,783)	無	0	無
董事	凱揚資本(股)公司	(216,000)	無	0	無
	黃俊育	(1,601,000)	無	0	無
董事	吳吉祥	(237,710)	無	0	無
董事	馬堅勇	(10,544)	無	0	無
獨立董事	黃永昌	4,000	無	0	無
獨立董事	薛銘鴻	(16,319)	無	0	無
獨立董事	賴憬頤	(2,092)	無	0	無
集團執行長	寇崇善	(41,870)	無	0	無
集團行政長	吳昇憲(註 1)	(480,799)	無	0	無
集團財務長	江慶偉	6,000	無	4,000	無
集團技術長	葉文勇(113/1/1 就任)	0	無	0	無
集團執行副總	張伯昌	0	無	0	無
集團副總暨市場開發總經理	許原華	(1,000)	無	0	無
真空製造總經理	王衍聖	(9,586)	無	0	無
系統整合總經理	賴文成(113/9/1 就任)	0	無	0	無
日揚電子科技(上海)有限公司總經理	王志紘	(8,937)	無	0	無
副總經理	楊鴻津	(23,313)	無	6,000	無
業務副總經理	黃揮仁(114/1/1 就任)	-	-	0	無
公司治理主管	羅筱秋	0	無	0	無
會計主管	黃湘君	0	無	0	無

註 1：為昇大實業有限公司之代表人。

註 2：包含 113 年本公司辦理現金減資所影響之股數。

(二)股權移轉資訊：無此情形。

(三)股權質押資訊：無此情形。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊

114 年 4 月 8 日；單位：股、%

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱或姓名	關係	
昇大實業有限公司代表人:吳昇憲	5,450,582	5.76	不適用	不適用	不適用	不適用	吳明田	父子	註
	1,923,192	2.03	176,674	0.19	5,450,582	5.76			
吳明田	5,180,482	5.48	0	-	0	-	昇大實業有限公司代表人:吳昇憲	父子	本公司之董事
可耀(股)公司代表人:林玉雁	3,864,000	4.09	不適用	不適用	不適用	不適用	無	無	無
	資料無法取得								無
中國信託商銀受託信託財產專戶	3,070,256	3.25	不適用	不適用	不適用	不適用	無	無	無
沈品秀	2,659,991	2.81	0	-	0	-	無	無	本公司之董事
賴智弘	2,413,838	2.55	資料無法取得						無
賴珮瑀	2,229,630	2.36	資料無法取得						無
高福來	2,216,913	2.34	資料無法取得						無
田美投資管理顧問有限公司:吳佳柔	2,162,642	2.29	不適用	不適用	不適用	不適用	吳明田	父女	無
	1,043,772	1.10	資料無法取得						無
胡嘉麟	2,124,200	2.25	資料無法取得						無

註：為本公司董事長(法人董事代表人)。

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

113 年 12 月 31 日；單位：股、%

轉投資事業 (註)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
Highlight Tech International Corp.	27,414,695	100	0	-	27,414,695	100
Htc真空株式会社	10,000	100	0	-	10,000	100
夏諾科技(股)公司	8,600,000	100	0	-	8,600,000	100
明遠精密科技(股)公司	10,189,353	30.32	3,523,422	10.49	13,712,775	40.81
實密科技(股)公司	2,551,120	60.96	635,270	15.18	3,186,390	76.14
德揚科技(股)公司	12,322,052	35.81	0	-	12,322,052	35.81
利梭貿易股份有限公司	5,000,000	100	0	-	5,000,000	100

註：係公司採用權益法之投資。

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源：最近年度及截至年報刊印日止，已發行之股份種類

114 年 4 月 8 日；單位：千股；千元

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
109.06	10	250,000	2,500,000	103,994	1,039,936	現金增資	—	(註 1)
110.02	28.3	250,000	2,500,000	115,418	1,154,175	可轉債轉換普通股	—	(註 2)
110.05	28.3	250,000	2,500,000	116,791	1,167,906	可轉債轉換普通股	—	(註 3)
	27							
110.09	27	250,000	2,500,000	117,128	1,171,276	可轉債轉換普通股	—	(註 4)
110.11	27	250,000	2,500,000	117,191	1,171,906	可轉債轉換普通股	—	(註 5)
111.02	27	250,000	2,500,000	118,202	1,182,017	可轉債轉換普通股	—	(註 6)
113.08	10	250,000	2,500,000	94,561	945,613	現金減資	—	(註 7)

註 1：經濟部商業司 109 年 05 月 29 日經授商字第 10901081810 號函核准現金增資 50,000 千元。

註 2：經濟部商業司 110 年 02 月 02 日經授商字第 11001016110 號函核准可轉債轉換普通股 114,239 千元。

註 3：經濟部商業司 110 年 05 月 03 日經授商字第 11001075250 號函核准可轉債轉換普通股 13,731 千元。

註 4：經濟部商業司 110 年 09 月 01 日經授商字第 11001148550 號函核准可轉債轉換普通股 3,370 千元。

註 5：經濟部商業司 110 年 11 月 26 日經授商字第 11001217770 號函核准可轉債轉換普通股 630 千元。

註 6：經濟部商業司 111 年 02 月 09 日經授商字第 11101011750 號函核准可轉債轉換普通股 10,111 千元。

註 7：經濟部商業司 113 年 08 月 12 日經授商字第 11330142150 號函核准現金減資 236,404 千元。

114 年 4 月 8 日

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份(註)	未發行股份	合計	
普通股	94,561,343 股	155,438,657 股	250,000,000 股	上櫃公司股票

註：流通在外股份為上櫃公司普通股。

總括申報制度相關資訊：不適用。

(二)主要股東名單

114 年 4 月 8 日；單位：股

股份 主要股東名稱	持有股數	持股比例
昇大實業有限公司	5,450,582	5.76%
吳明田	5,180,482	5.48%
可耀股份有限公司	3,864,000	4.09%
中國信託商銀受託信託財產專戶	3,070,256	3.25%
沈品秀	2,659,991	2.81%
賴智弘	2,413,838	2.55%
賴珮瑤	2,229,630	2.36%
高福來	2,216,913	2.34%
田美投資管理顧問有限公司	2,162,642	2.29%
胡嘉麟	2,124,200	2.25%

(三)公司股利政策及執行狀況

1.公司股利政策

(1)第卅一條之一：

本公司盈餘分派於每半會計年度終了後為之，每半會計年度決算如有盈餘時，應先提繳稅款，彌補以往年度虧損，預估保留員工酬勞及董事酬勞，次提百分之十法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限，另依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，其餘額加計以前年度累積未分配盈餘，作為可供分派之股東股息及紅利，其分派數額由董事會擬具盈餘分配案，以現金方式為之時，應經董事會決議；以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之，本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往年度虧損，次提百分之十為法定盈餘公積；但法定盈餘公積已達法令規定數額時，不在此限，另依法提列或迴轉特別盈餘公積後，就其餘額併同上半會計年度累積未分配盈餘調整數額，由董事會擬具盈餘分配案，以現金方式為之時，應經董事會決議；以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之。

本公司依公司法第二百四十條第五項規定，授權董事會以三分之二以上董事出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利或公司法第二百四十一條第一項規定之法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

(2)第卅一條之二：

本公司屬科技業，目前為高度成長期，研發與提升產能為競爭力，與永續經營關鍵，需不斷投注資金進行投資，故本公司現階段之股利政策係依據公司未來資本預算規劃衡量未來年度資金需求後，採部份股票股利發放以保留公司營運所需資金，但若因此造成獲利能力大幅稀釋，則由董事會參考營運及資本支出，及股東對現金流入之需求，擬定合適之現金與股票股利搭配比例，現金股利佔股利總額比例不低於百分之二十。

本公司為電子零組件製造業，持續研發與提升產能競爭力，永續經營關鍵需不斷投注資金進行投資，本公司現階段之股利政策係依據公司未來方向及目標規劃，衡量未來年度資金需求後，擬定合適之現金或股票股利政策。

2. 本次股東會擬議股利分配之情形

經本公司 114 年 3 月 4 日董事會決議，自 113 年度盈餘中提撥分派現金股利新台幣 113,474 千元，每股配發現金股利新台幣 1.2 元，及資本公積發放現金新台幣 75,649 千元，每股配發現金新台幣 0.8 元，合計每股配發新台幣 2.0 元，股東現金股利按除息基準日股東名簿所載股東持有股數，將於 114 年 7 月 11 日發放。

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

(五) 員工、董事及監察人酬勞：

1. 公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍

依公司法及本公司章程規定，本公司年度如有獲利，應提撥 10%~15% 為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之控制或從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於 2% 為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。

但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

本公司盈餘分派於每半會計年度終了後為之，每半會計年度決算如有盈餘時，應先提繳稅款，彌補以往年度虧損，預估保留員工酬勞及董事酬勞，次提百分之十法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限，另依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，其餘額加計以前年度累積未分配盈餘，作為可供分派之股東股息及紅利，其分派數額由董事會擬具盈餘分配案，以現金方式為之時，應經董事會決議；以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之，本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往年度虧損，次提百分之十為法定盈餘公積；但法定盈餘公積已達法令規定數額時，不在此限，另依法提列或迴轉特別盈餘公積後，就其餘額併同上半會計年度累積未分配盈餘調整數額，由董事會擬具盈餘分配案，以現金方式為之時，應經董事會決議；以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之。

本公司依公司法第二百四十條第五項規定，授權董事會以三分之二以上董事出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利或公司法第二百四十一條第一項規定之法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

2. 本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理

(1) 員工及董事酬勞金額之估列基礎係依公司章程所載成數範圍及過去經驗可能發放之金額為基礎。

(2) 實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：若次年度董事會決議實際配發金額與估列數有差異時，則依會計估計變動處理，於董事會決議年度調整損益。

3. 董事會通過分派酬勞情形

(1) 以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額

本公司民國 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派，業經民國 114 年 3 月 4 日董事會通過，擬分派員工酬勞新台幣 40,985 千元，董事酬勞新台幣 8,197 千元。前述員工酬勞及董事酬勞與民國 113 年度認列之費用並無差異。

(2) 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：無。

- 4.前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形（包括分派股數、金額及股價）、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形
113 年 3 月 8 日董事會決議分派 112 年度董事酬勞為 9,574 千元，以現金分派之員工酬勞為 54,573 千元；董事會決議分派之員工、董事酬勞與 112 年度財務報表認列之員工、董事酬勞並無差異。

(六)公司買回本公司股份情形：截至年報刊印日止，本公司未買回公司股份。

二、公司債辦理情形：截至年報刊印日止，本公司未有公司債辦理情形。

三、特別股辦理情形：截至年報刊印日止，本公司未有特別股辦理情形。

四、海外存託憑證辦理情形：截至年報刊印日止，本公司未有海外存託憑證辦理情形。

五、員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形：截至年報刊印日止，本公司未有員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形。

六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：截至年報刊印日止，本公司未有併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形。

七、資金運用計畫執行情形：截至年報刊印日止，本公司未有前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現情形。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.所營業務之主要內容

- 標準真空零組件及真空閥設計、製造及銷售。
- 半導體、光電及鍍膜設備之客製化零件設計(ODM)、加工、精密焊接、組裝及測試。
- 客製化各式真空鍍膜腔體、模組與系統設計製造或委託製造(Contract Manufacture)。
- 學術研究機構高真空與超高真空腔體與模組設計製造。
- 抗凍劑代理銷售及相關整合服務。
- 真空泵浦新品銷售及維修。
- CIP 改管工程及 ESG Heater Jacket 銷售等。
- 全物理清洗 (包括雷射除汙、磁力研磨等)。
- Y2O3、Al2O3、SiO2、WEH® (Fluoride) coating。
- 半導體設備之功率源及次系統維修服務及買賣。
- 微波電源系統及可攜式電漿源系統監測分析及升級服務。
- 鋁合金硬質陽極處理及化學清洗服務。
- Micro-bubble wet scrubber 節能及減廢設備、關鍵零件、開發製造銷售及維護保養服務。

2.所營業務之營業比重

產(商)品 \ 年度	113 年度
商品銷貨收入	64%
勞務收入	35%
其他	1%
總計	100%

註：其他為租金及佣金收入。

3.公司目前之主要商品(服務)項目

本公司主要從事專業製造真空零組件、真空閥設計、製造及銷售；Micro-bubble wet Scrubber節能及減廢設備、關鍵零件、開發製造銷售及維護保養服務；真空泵浦新品銷售及維修、CIP改管工程、WEH Coating及ESG Heater Jacket銷售等，以提供半導體、光電、生化科技、醫療、食品、科研、學術單位...等產業及國內外設備廠商等高科技客戶，提供最完善的技術服務、化學表面處理、微波應用設備、電功率源維修、電漿製程微波系統監測及分析、廢氣濕式洗滌設備之關鍵零組件銷售及維修服務。

4.計畫開發之新商品(服務)

- 真空閥門性能優化，除了驗證可靠性之外，將投入研發具備低震動、低粉塵、耐高溫及快速作動等性能的閥門。
- 開發三位置設定之蝶閥與鐘擺閥，提供設備商搭配設備使用。
- 開發馬達驅動之真空閥，並開發控制軟體以組成具備壓力控制功能的真空閥，提供國際及國內系統廠商，搭配設備使用。並與感測器設計廠商配合，在閥門內建適當的感測器以監控相關溫度、壓力、震動及粉塵量等參數，以維持設備正常運作。
- 找尋其他配套設備供應源搭配自有設備出售，期間利用機會找尋其他未來有潛力的產品發展。
- 開發金屬封合之真空閥門，可耐高溫並可達到極低的壓力，進入超高真空之科研應用市場。
- 結合真空、微波、電漿等技術及應用，開發製造環保、節能、減廢之設備或產品，進入工業及民生用品市場。
- 開發新型 Microwave Scrubber 設備，提供客戶在廢氣處理上最佳的選擇並且能夠符合國內外相關法規之規範。
- 開發第三類半導體相關製程設備，進行市場佈局。
- 開發 WEH Coating 及 ESG Heater Jacket...等，新形式材質及配件，進行半導體及鍍膜市場的佈局。

(二)產業概況

1.產業之現況與發展

真空系統係指在真空狀態下存在之系統，運用真空物理之特性，將真空室室內壓力降至工作所需之壓力範圍中，以達到製程需求環境之系統，特別在尖端科技上之運用，更是真空產業發展之趨勢，相關應用製程如離子披覆(Ion implant)技術，超大型積體電路製作、核融合發電、加速器、光碟儲存媒體及平面顯示器等相關設備，皆需要較高的真空要求或潔淨度，以製造更高品質之產品。

一般真空系統之組成元件包括有真空泵(Vacuum Pump)、真空閥(Vacuum Valves)、真空計(Vacuum Gauge)、真空室(Vacuum Chamber)、法蘭(Flange)、接頭(Connector)、真空引入(Vacuum Feedthrough)、視窗(Window)、阱(Trap)、擋板(Baffle)等不同元件。

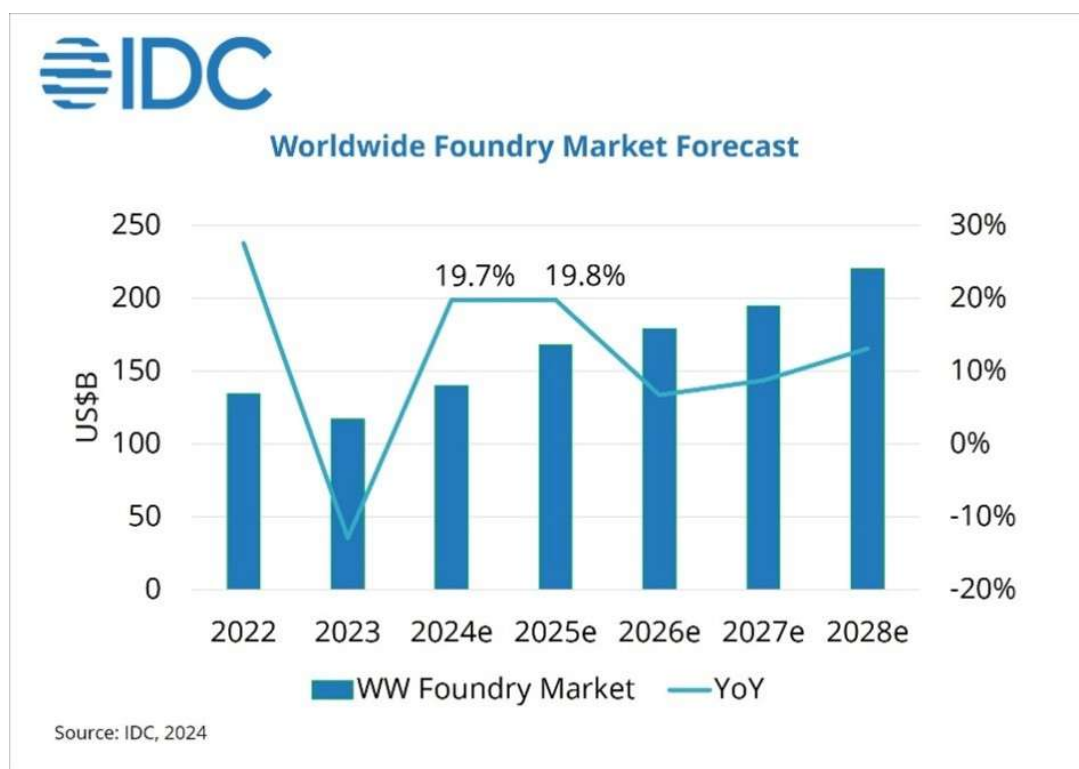
與日揚公司經營項目相關的半導體產業、平面顯示器產業、砷化鎵產業及 LED 產業皆與全球經濟發展、產業技術變化和市場需求有密切關聯，因此就相關產業發展進行探討。

全球半導體產業趨勢與展望

根據 IDC (國際數據資訊) 113 年 12 月最新研究顯示，由於 114 年全球人工智慧 (AI) 與高效能運算 (HPC) 需求持續攀升，從雲端資料中心、終端裝置到特定產業類別，各個主要應用市場均面臨規格升級趨勢，半導體產業將再度迎來嶄新榮景。

在 AI 持續推升高階邏輯製程晶片需求，以及高價 HBM 滲透率提升的推動下，預計 114 年整體半導體市場將成長超過 15%；半導體供應鏈包括設計、製造、封測、先進封裝等產業，在上下游橫縱合作之下，將共創新一波成長契機。

■全球晶圓代工市場預測



IDC預測114年半導體市場將具備下列八大趨勢：

(1) 114 半導體：AI 驅動的高速成長仍將持續

114 年半導體市場預計將成長 15%。記憶體領域可望成長超過 24%，主要動能來自 AI Accelerator 需要搭配的 HBM3、HBM3e 等高階產品滲透率持續提升，以及新一代 HBM4 預計於 114 下半年問世所帶動。非記憶體領域則可望成長 13%，主要受惠於採用先進製程晶片，如 AI 伺服器、高階手機晶片等需求暢旺，另外成熟製程晶片市場也將在消費電子市場回溫激勵下預期有正面表現。

(2) 亞太區 IC 設計市況升溫，114 年可望再成長 15%

亞太 IC 設計業者產品線豐富多元，應用領域遍布全球，包含 Smartphone AP、TV SoC、OLED DDIC、LCD TDDI、WiFi、PMIC、MCU、ASIC 等必要晶片。隨著庫存水位大致得到控制、個人裝置需求回暖，以及 AI 運算需求延伸至各類應用都帶動整體需求，預計 114 年亞太 IC 設計整體市場將持續成長，年成長率達 15%。

(3) 台積電將持續稱霸 Foundry1.0 與 Foundry2.0 領域

在傳統 Foundry1.0 的定義下，台積電市佔從 112 年的 59% 穩健攀升，預期 113 年將達 64%，114 年更將擴大至 66%，遠超三星、中芯國際、聯電等競爭對手。而在 Foundry2.0 定義中(包括晶圓代工、非記憶體 IDM 製造、封測、光罩製作)，112 年台積電市佔為 28%，但在 AI 驅動先進製程需求大幅提升的態勢下，預期市佔將在 113、114 年快速攀升，展現在新舊產業結構下的全方位競爭優勢。

(4)先進製程需求強勁，晶圓代工廠擴產加速

先進製程（20nm 以下）在 AI 需求推動下加速擴產。台積電不僅在台灣廠區持續打造 2nm 及 3nm，美國廠區 4/5nm 也即將量產。三星則憑藉著搶先進入 GAA 世代的經驗，在韓國華城（Hwaseong）打磨 2nm。而英特爾在新策略規劃下壓注 18A 製程開發，並以吸引更多外部客戶為未來幾年的目標。整體來看，預計晶圓製造 114 年產能年增 7%，其中先進製程產能將年增 12%，平均產能利用率可望維持 90% 以上高檔，AI 需求驅動引爆的半導體榮景持續發酵。

(5)成熟製程市況回溫，產能利用率將逾 75%

成熟與主流製程（22nm-500nm）應用範圍廣泛，涵蓋消費性電子、車用、工控等領域。展望 114 年，預期在消費電子帶動，以及車用與工控領域可望出現零星庫存回補動能下，整體需求將持續回溫。8 吋晶圓廠平均產能利用率可望從 113 年的 70% 攀升至 75%，12 吋成熟製程平均產能利用率也將提升至 76% 以上，預期 114 年晶圓代工產能利用率平均提升 5 個百分點。

(6)2nm 為 114 晶圓製造技術關鍵年

114 年將是 2nm 技術的關鍵年，三大晶圓製造商都將進入 2nm 量產。台積電戮力於新竹及高雄擴廠，預計在下半年穩健邁入量產。三星將依循往年一貫作風，預計較台積電早邁入生產。英特爾則在戰略調整下，全力聚焦導入晶背供電（BSPDN）的 18A。在 2nm 世代，三大廠商將面臨 PPAC（效能、功耗、體積、價格）的嚴峻挑戰，包括晶片效能、功耗表現以及單位面積成本的整體最佳化，尤其 2nm 製程將同步啟動 Smartphone AP、Mining Chip、AI Accelerator 等關鍵產品的量產，屆時各家的良率爬升速度與擴產節奏將成市場關注焦點。

(7)封測產業生態重整，中國市佔將持續擴張，台灣 AI 封測優勢攀升

地緣政治影響之下，全球封測版圖正在重組。中國在「半導體自主化」政策推動下，晶圓代工成熟製程產能快速成長，下游 OSAT 產業也隨之擴張，正形成完整的製造產業鏈。台廠在此態勢下展現另一面產業優勢，不僅加速在台灣及東南亞布局產能，也深耕 AI 晶片先進封裝技術。展望 114 年，中國封測市佔將持續上揚，台廠則鞏固在 AI GPU 等高階晶片的封裝優勢。預計 114 年整體封測產業將成長 9%。

(8)先進封裝：FOPLP 布局深耕，CoWoS 擴產倍增

半導體晶片功能與效能要求不斷提高，先進封裝技術日益重要。在 FOPLP 方面，114 年起將快速成長，目前以玻璃 Base 製程為主，應用於 PMIC、RF 等小型晶片，預計技術累積數年後可望進軍封裝面積要求更大的 AI 晶片市場，並導入技術門檻要求更高的玻璃 Base 產品。另外，在 NVIDIA、AMD、AWS、Broadcom 與雲端服務供應商（CSP）等高效能運算客戶需求推動下，台積電 CoWoS 產能持續倍增，目標將從 113 年的 33 萬片大幅擴充至 114 年的 66 萬片，年增 100%，其中以 CoWoS-L 產品線年增 470% 為主要動能，而台灣設備供應鏈包括濕蝕刻、點膠、揀晶等關鍵製程設備廠商，將在此波擴產潮中獲得更多成長契機。

IDC 指出，114 年全球半導體產業將持續以雙位數成長，但仍需因應多重變數：包括地緣政治風險、全球經濟政策（包括產業補助、貿易關稅、貨幣利率等）、終端市場需求以及新增產能帶來的供需變化，都是 114 年半導體產業值得關注的重要面向。

晶圓代工排名

根據 TrendForce 最新調查，113 年第四季全球晶圓代工產業呈兩極化發展，先進製程受惠於 AI 伺服器等新興應用增長，以及新款旗艦級智慧手機 AP 和 PC 新平台備貨週期延續，帶動高價晶圓出貨增長，抵銷成熟製程需求趨緩帶來的衝擊，前十大晶圓代工業者合計營收季增近 10%，達 384.8 億美元，續創新高。

分析 113 年第四季各主要晶圓代工業者受惠於智慧手機、HPC 新品出貨動能延續，台積電（TSMC）晶圓出貨季增，營收成長至 268.5 億美元，以市占率 67% 之姿穩居龍頭。

第二名三星（Samsung Foundry）由於先進製程新進客戶投片帶來的收入難以完全抵銷主要客戶投片轉單造成的損失，第四季營收微幅季減 1.4%，為 32.6 億美元，市占 8.1%。

第三名中芯國際（SMIC）於 113 年第四季受客戶庫存調節影響，晶圓出貨呈現季減，但受惠於十二吋新增產能開出，優化產品組合帶動 Blended ASP 季增，兩者相抵後，營收季增 1.7% 至 22 億美元，市占 5.5%。

第四名聯電（UMC）第四季因客戶提前備貨，產能利用率、出貨情況皆優於預期，減緩 ASP 下滑的衝擊，營收僅季減 0.3%，達 18.7 億美元。

第五名格羅方德（GlobalFoundries）晶圓出貨同樣季增，部分與 ASP 微幅下滑相抵，營收較前一季成長 5.2%，為 18.3 億美元。

第六名華虹集團（HuaHong Group），旗下 HHGrace 十二吋產能利用率略增，帶動晶圓出貨、ASP 皆微幅成長。另一子公司 HLMC 明顯受惠於中國家電、消費補貼庫存回補，產能利用率成長。綜合上述原因，HuaHong Group 營收季增 6.1%，達 10.4 億美元。

第七名高塔半導體（Tower），113 年第四季產能利用率下滑的影響與 ASP 改善相抵，營收季增 4.5% 至 3.87 億元。

第八名世界先進（VIS），其第四季晶圓出貨、產能利用率因消費性需求走弱而下降，部分與 ASP 成長相抵，營收為 3.57 億元，季減 2.3%。

值得注意的是，合肥晶合集成（Nexchip）雖面臨面板相關 DDI 拉貨放緩的挑戰，但有 CIS、PMIC 產品維繫出貨動能，113 年第四季營收季增 3.7% 至 3.44 億元，市占排名上升至第九名，為此次唯一有變動的名次。

力積電（PSMC）則因記憶體代工與消費性相關需求皆走弱，營收季減而排名滑落至第十名，但若以 113 全年情況來看，力積電營收仍略高於合肥晶合集成。

■113Q4全球前十大晶圓代工業者營收排名

4Q24全球前十大晶圓代工業者營收排名

(單位：百萬美元)

Ranking	Company	Revenue			Market Share	
		4Q24	3Q24	QoQ	4Q24	3Q24
1	台積電(TSMC)	26,854	23,527	14.1%	67.1%	64.7%
2	三星(Samsung)	3,260	3,305	-1.4%	8.1%	9.1%
3	中芯國際(SMIC)	2,207	2,171	1.7%	5.5%	6.0%
4	聯電(UMC)	1,867	1,873	-0.3%	4.7%	5.1%
5	格羅方德 (GlobalFoundries)	1,830	1,739	5.2%	4.6%	4.8%
6	華虹集團 (Huahong Group)	1,042	982	6.1%	2.6%	2.7%
7	高塔半導體(Tower)	387	371	4.5%	1.0%	1.0%
8	世界先進(VIS)	357	366	-2.3%	0.9%	1.0%
9	合肥晶合(Nexchip)	344	332	3.7%	0.9%	0.9%
10	力積電(PSMC)	333	336	-0.7%	0.8%	0.9%
Total of Top 10		38,482	35,001	9.9%	96%	96%

備註1：3Q24--1美元兌換1,355韓圓；1美元兌換32.3台幣

備註2：4Q24--1美元兌換1,399韓圓；1美元兌換32.3台幣

備註3：三星僅計入晶圓代工事業部之營收

備註4：力積電僅計入記憶體與邏輯晶圓代工營收

備註5：華虹集團包含華虹宏力及上海華力

Source: TrendForce, March 2025



另外根據 TrendForce 另一份資料統計，中系主要晶圓代工廠 28 奈米以上成熟製程產能，自 109 至 113 年產能增幅接近翻倍。大量成熟製程產能開出，一方面將滿足國產替代 IC 需求，另一方面也造成產能過多、總體經濟與終端需求銷售尚未回暖，因而代工價格備受壓力情境。

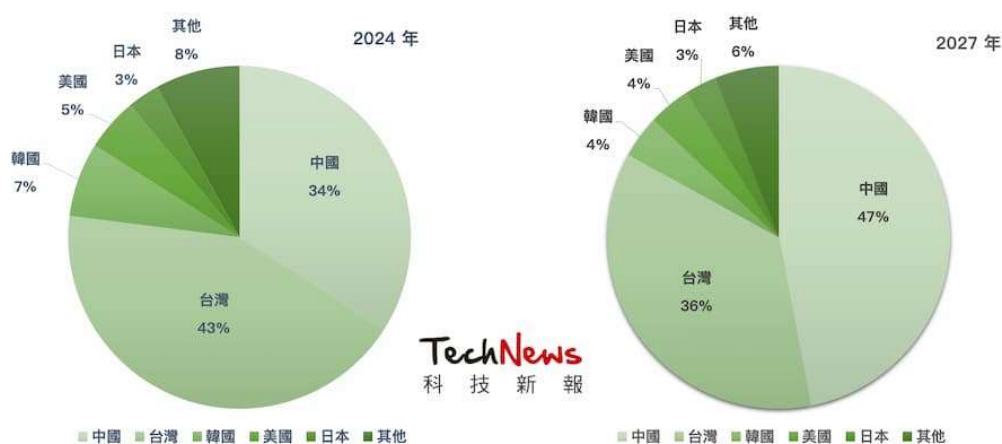
TrendForce 指出，自 114 年開始，中系晶圓代工廠將成為成熟製程增量主力，預期 114 年全球前十大成熟製程代工廠的產能將提升 6%。另隨著新產能釋出，今年底中系晶圓代工廠的成熟製程產能在前十大業者占比將突破 25%，尤以 28/22nm 新增產能最多。

成熟製程主要用於驅動 IC、電源管理 IC、微控制器 (MCU) 晶片，而中國成熟製程指標廠包括中芯國際、華虹半導體、聯芯、晶合集成等；台廠以聯電、力積電、世界先進為主，美國則是格羅方德。

隨著中國晶圓產能快速擴張，全球成熟製程市場無可避免地受到衝擊，特別是美國的格羅方德 (GlobalFoundries) 以及台灣的聯電、力積電與世界先進等業者。

■113 vs 116年成熟製程各地產能占比

2024 vs 2027 年成熟製程各地產能占比



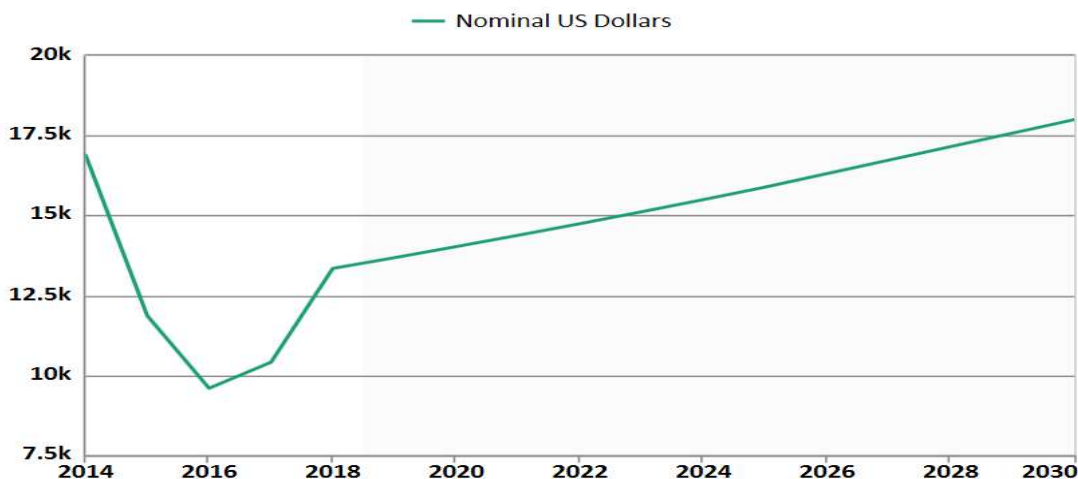
資料來源：TrendForce，科技新報整理

綜觀而言，中國成熟製程產能的持續擴張無疑將對全球供應鏈與市場價格帶來壓力。然而，隨著川普再度上任，美國重新啟動 301 條款，外國廠商選擇中國晶片的難度可能進一步提高，同時加速半導體業者轉向東南亞等海外市場進行布局。川普政府是否會對中國半導體業祭出新一波打擊手段，仍有待進一步觀察。

2.產業上、中、下游之關聯性

真空產業上游之主要原物料如不銹鋼價格持平，國內廠商已經可以供應部分高階鋼材如316LN ESR，有助於爭取高單價產品，但是鋼材採購仍有最小批量的限制，而且製造產品需要各種不同尺寸規格的鋼材，對於加工廠，鋼材庫存會造成不小的資金壓力。

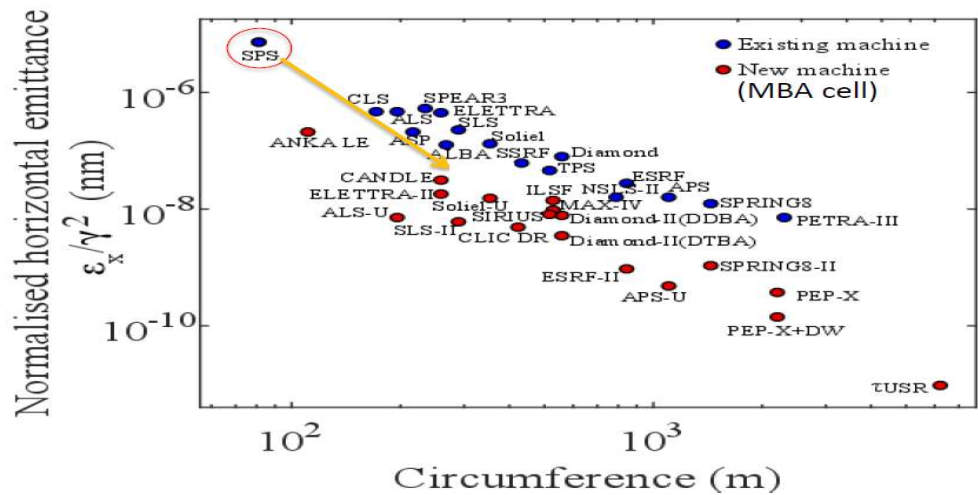
■世界銀行預測鎳價走勢 \$/mt



真空產業的上游是材料及零部件廠商，其中高階材料及關鍵零部件如高真空泵或真空計仍由先進國家掌握，中游是設備商集中在日本及歐美，雖然近年國際設備大廠陸續在亞洲設立組裝廠，但是設計研發主要還是在原廠，下游是電子產品製造商，大都集中於亞洲。

研究機構也是真空應用的主要場所，除了各大學之外，同步輻射加速器是使用最多超高真空產品的單位，因為其構造龐大而且對真空度和潔淨度的要求極高，僅有少數供應商有承包其設備及工程的能力。針對未來10年內之世界各國多座同步加速器先進光源設施（新建及升級-New Light Source or Upgrade）建造所需之真空系統腔體元件，可以爭取由台灣同步輻射中心輔導台灣真空製造廠家承包，藉由真空技術轉移與教育訓練、加速器真空系統設計諮詢顧問、協助接洽與拜訪國外加速器機構及參加國際會議展示宣傳等活動，以協助廠家分工合作獲得承包國際加速器真空系統元件製造訂單。

■近年世界新建超低發散度光源設施



3.產品之各種發展趨勢及競爭情形

真空技術為現代科技產業的基礎，舉凡半導體、光電、生技、醫療、能源、食品等在內，每一個市場對真空產業而言都具有重要的地位。其中，因半導體代工與TFT-LCD面板生產地區集中在亞洲，不僅帶來相當大的真空設備需求商機，另一方面半導體/平面顯示器市場需求又與全球景氣波動緊密連動，廠商在設備投資或是實施庫存調整的同時，也決定真空設備與機器的市場需求。

高階材料及關鍵零部件如高真空泵或真空計仍由歐美日等先進國家掌握，各大真空廠也有集團化的趨勢，例如瑞典Atlas Copco集團先後併購了英國Edwards和德國Leybold及Brooks cryo pump部門，而德國Pfeiffer也併購了法國Adixen和美國NorCal，但是仍然維持原有的品牌在市場銷售。中國也在積極發展真空關鍵部品如乾式真空泵，甚至研發前段半導體真空設備，未來十年內在真空品牌市場可能占得一席之地。

(三)技術及研發概況

1.最近年度之研究發展費用

單位：新台幣千元

年度	112 年度	113 年度
研發費用	229,470	221,261
營業淨額	4,205,436	3,934,267
研發費用占營業總額比例	5%	6%

2.開發成功之技術或產品

年度	產品名稱	用途及效能說明
113 年	快速關閉閘閥	1. Fast Shutdown Valve 採用簡單易維護的設計，具備在 1 bar 壓差下快速開關的能力，適用於泵浦隔離及高含副產物氣流的應用。其楔形結構專為高粉塵氣流隔離設計，通常安裝於真空泵進氣端，能在異常停機時快速關閉，確保系統穩定。 2. 隨著半導體廠對工業安全的重視，LOTO(上鎖與掛牌)功能需求增加。快速關閉閘閥的 LOTO 選配可防止誤操作，提升操作安全與產品可靠性。 3. 此新產品可提升市場佔有率與國際競爭力。
	半導體設備用低震動、低發塵電動矩形閥	1. 隨著半導體設備進入 5nm 以下製程，設備商對閥門的振動與微塵要求越來越高。針對此需求，開發了低震動、低發塵的矩形閥以滿足關鍵製程要求。 2. 產品整合了多項技術，包括避免粒子生成的 L-Motion 技術、T bar 與 Bellows 軸密封技術、壓杆技術均勻分佈閘板壓力，以及創造平滑低衝擊運動的連貫技術。通過控制進排氣壓力變化，降低閥門震動並減少微塵產生。 3. 產品具備操作簡易、低震動、低發塵等優勢，可提升市場佔有率與國際競爭力。
	多片式 APC 蝶閥	1. 大尺寸單片式控壓蝶閥需要較大厚度空間，會影響 Pump 抽氣能力並導致氣流不均。 2. 多片式 APC 蝶閥能有效解決厚度問題，閥體較薄，氣流流動均衡，開關速度更快，並具備控壓功能，可滿足客戶多重選擇與需求。
	Dry Pump 轉子開發	1. 解決缺料問題，同時提高關鍵零組件自給自足。 2. 針對維修量最大的 7 款 Dry Pump 開發所需要的轉子。
	動平衡技術	1. 轉子不平衡量過大，會導致提前下機，因此需進行動平衡校正。此技術建立自有動平衡能力，避免耗費人力物力進行委外校正。 2. 可進行機檯作業確認及兩款轉子校正手法。
	智慧化半導體製程尾氣處理系統	目前許多尾氣設備需要定期人力巡檢和保養，這項解決方案可降低人力成本並提供即時警示。 1. SCMS 1.0: 基於 Windows 平台，通過在 Chamber、閥門、渦輪泵、乾式泵、Scrubber、管路上安裝感測器，進行即時尾氣監測。 2. SCMS 2.0: 基於 Linux 平台的網頁和虛擬容器，專注於乾式泵需求，具備壽命預測 AI 與視覺化平台，具有開發彈性和可移轉至不同系統的優勢。

年度	產品名稱	用途及效能說明
	濕式清洗設備 振動測試平台	1. 在半導體濕式去除光阻清洗設備中，轉子高速旋轉時，晶片批量與重量分布不均會引發過大震動，導致晶片碎裂。 2. 開發轉子平衡校正平台與減震技術，成功解決清洗不同材質晶片（如 Si、GaAs、SiC 等）時的破片問題。
	半導體濕式清洗設備	1. 全自主設計的設備用於半導體去光阻與清洗製程。 2. 日揚具備完整的線路配盤設計和操作軟體開發能力，可針對關鍵零件進行設計與製造。 3. 設備可根據客戶需求調控清洗參數，保持清洗腔高潔淨度，確保去光阻與清洗的時間和均勻度要求。
	乾式臭氧去光阻設備	1. 利用臭氧高活性自由基氧化有機物，開發乾式去除光阻之半導體設備。 2. 適用於解決 3D IC 製程中較深、不易去除光阻的問題，更能減少溼式去除製程需要的化學品用量。

(四)長、短期業務發展計畫

1.短期業務發展計畫

- 整合上、中、下游產業鏈，開發半導體及光電產業廠務系統之尾氣處理設備，成為真空領域完整解決方案供應商。
- 強化真空產業價值鏈之延伸，切入管路設計/拆裝(Piping)的市場，擴大 Micro-bubble wet scrubber 銷售，提供客戶從 Valve、Chamber、Dry pump、Turbo pump、Piping、Scrubber 等一條龍的服務。
- 評估新增區域代理商，推廣自有品牌閥門。
- 協同系統商及工程公司進行資源整合單，擴大接單能力。
- 擴大 Micro-bubble wet scrubber 銷售，提供 subfab 整合方案。
- 提供客戶真空相關的技術服務，讓客戶在設計初期就可以得到專業的技術提供，成為客戶心中無法被取代的夥伴。
- 推廣全物理清洗，落實 ESG 永續計畫。
- 推廣環保型節能加熱帶，滿足客戶對節能產品之需求。

2.長期業務發展計畫

- 跟隨客戶海外佈局，推廣海外業務。
- 打進國/內外設備商成為其真空閥門 Tier 1 供應商。
- 開發關鍵零組件，創造高附加價值，提供客戶銷售/代工/維修/諮詢等服務。
- 延伸關鍵零組件技術，擴大應用到其它產業。
- 評估海外市場代理商/經銷商，將自有品牌推廣至新市場。
- 整合電源維修、Parts clean、Pump 維修、尾氣處理、真空部品等客戶最需要的服務和產品，爭取擴展市場和服務升級以創造雙贏。
- 培養專業工程師建立鋁合金焊接技術，以承接超高真空或超高潔淨鋁合金元件訂單。
- 參加產學聯盟計畫，經由輔導、技轉等方式建立超高真空相關技術，爭取承包國際加速器真空系統元件機會。
- 持續評估市場和技術資訊，尋找合適標的進行投資、併購或技術移轉。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.主要商品(服務)之銷售(提供)地區

單位：新台幣千元；%

年度 地區	112 年度		113 年度	
	銷貨金額	%	銷貨金額	%
內銷	3,376,739	80%	3,324,920	85%
外銷	828,697	20%	609,347	15%
合計	4,205,436	100%	3,934,267	100%

2.市場占有率

本公司代理之 Edwards 渦輪分子式真空泵在台灣市場占有率遠高於同業，真空閥門亦維持最大維修商，以及 Dry pump 維修目前居前三大，以及 Third Party 之冠，然而台灣的半導體廠規模在世界上名列前茅，並且以最先進的製程來生產，因此日揚公司每年維修的半導體次系統 (Subsystem) 數量每年逐步上升。

3.市場未來之供需狀況與成長性

成熟製程受中國產能大幅開出，近兩年影響台灣各大晶圓廠，間接影響維修業務接單，惟美國對美國廠商下單中國晶圓廠規範越趨嚴謹，台灣成熟製程的晶圓廠受中國過剩產能衝擊可望逐步降低。先進製程方面，隨台積電擴充產能，市場需求將逐漸復甦。

4.競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1)競爭利基

A.滿足工業標準及高品質的要求，進入國際市場

真空零組件及設備的製造銷售，真空零組件之製作從設計開始每一個步驟都會影響產品的成敗，如正確的選擇材料、適當的尺寸配合及特殊的焊道設計與精密熔接等，而製造時則需保持工件潔淨，表面無損傷及原材料的品質控制，產品完成後需經由精密檢視，是否焊接完整與空焊。日揚公司的設計人員、製程管制及加工人員已累積 20 年以上的真空相關經驗，建立標準的流程，並將此技術應用於真空閥門、焊接膜片型波紋管、真空腔體及系統的製造，亦是國內唯一擁有此能力之廠商。由於日揚公司目前真空零組件，已得到國際真空大廠的採用，成為 ODM 與 OEM 的對象，並經過美國及日本真空設備業者之認證，順利打入美日市場，並為國內主要半導體及光電廠商之供應商，即為國內外客戶對本公司技術及品質認同之最佳佐證。

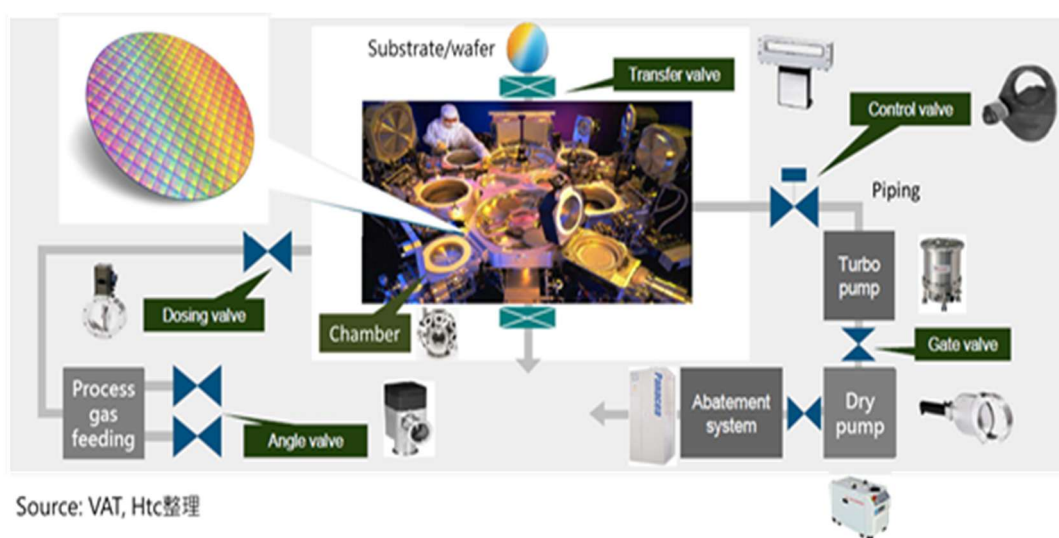
B.完整的真空泵與真空系統維修能力

真空泵的銷售及維修，本公司之技術完全集中於高真空或高潔淨泵之領域，即渦輪分子泵、螺旋式及機械乾式泵，日揚公司的渦輪分子泵維修工程師每年安排至日本原廠接受嚴格的訓練，原廠技師亦不定期來台作技術交流。本公司於新竹及台南兩地皆設立完整維修中心，工具及設備之先進甚至超越日本原廠，維修品質

廣受客戶好評，相較國內其他代理業者需將設備送回原廠維修相比，為國內目前在台灣唯一擁有此類真空泵維修技術之代理業者。再加上台南樹谷新廠所設置的自動清洗線於 112 年已投入服務，日揚自行搭建 For 先進製程專用之 100 等級高潔淨度清洗線及 1,000 等級無塵室，成為業界第一且唯一，自清洗，維修，組立，測試...全製程一條龍之維修廠商。並在維修技術之純熟，以及時效性上能配合國內業者需求，再加上真空系統所需的各項零組件供應，與整體系統的解決方案，不單限於一種真空泵，或是真空腔體，而是客戶最在乎的整體真空系統的順利運轉。

日揚公司在市場的定位與方向將朝 Total Service Solution 發展，藉由整合性服務方案提供客戶更完整便捷的設備及技術服務，致力滿足市場客戶需求。因此日揚公司維修團隊已成為大部分園區廠商的設備能夠正常運轉不可或缺的關鍵夥伴。

■下圖是真空系統 layout 圖



(2)發展遠景之有利、不利因素與因應對策

A.有利因素

潛在市場龐大

對消費性電子、汽車零件鍍膜、刀具鍍膜產業隨科技發展、環保、節能等趨勢下，再加上製造與市場大陸化的過程中，真空設備已廣泛應用於半導體及光電等產業，而未來隨著科技發展，產品精密度要求提升，科技產業對真空環境之要求將日益嚴格，因此對真空泵之需求量，功能之要求亦將提升。國內半導體在國內等大廠持續投入，光電產業則在 TFT-LCD 業者帶動下，其設備需求仍將再成長，而配合這些產業設備之投入、高科技廠房、無塵室、真空設備、零組件之需求亦將帶給業者龐大之商機。

由於此一市場在台灣業者技術成熟度不足下，大抵由外商壟斷。唯在國內需求市場量大，且對維修服務功能要求前提下，國外廠商亦開始尋求維修技術移轉之對象，因此未來國內廠商若能在技術支援無虞且擁有生產能力，再配合地利之便，將有極大之發展空間。

產業強調售後服務及維修保養能力，有利本土設備廠商發展

由於真空製程設備，大部分為高科技廠商配合生產製程量產之用，因此真空設備本身之效率將影響使用者對產品品質之控管。因此真空設備雖非投產所需，卻為製程控制之必要設備，且影響產品良率甚巨，客戶除了對真空設備功能、成本之要求外，其對未來售後服務、維修保養能力及維修時效性之要求均極為嚴苛，而維修保養能力往往是客戶購買設備之關鍵性考量因素。能就近提供及時之維修與保養乃本公司之優勢。

水平整合、自製真空零組件，提供客戶全方位服務，易取得認同

為防止缺料斷鏈的風險，日揚公司已著手朝向關鍵零組件的開發，此外真空設備之維修保養，諸如零組件配合，除了核心之真空泵外，尚需法蘭、夾鉗、中心圈、密封墊片、各式閥件、真空管件及伸縮軟管等零組件，且需定期維修更替，因此除了真空泵外，其相關組件是否得以及時有效之配合，亦是維修成效之關鍵。由於國內業者在零件部分技術已成熟，因此透過水平整合之效益，對國內業者將提供相對有利之環境。

與國內外學術及產業界技術合作，有效掌握資訊與技術來源

由於真空設備製造業為技術、資本密集產業，進入障礙較高，且歐、美、日等先進國家已累積數十年經驗，日揚公司在資金及人力資源均有所差距下，積極與國內學術單位，如工研院、中科院及金屬工業中心、台灣大學及成功大學等單位合作開發設備零組件等產品以進一步提升設備維修及保養之能力，並進而取得未來先進研發之契機。

政府政策鼓勵

光電、半導體產業為政府持續重點輔導產業，而針對上游設備產業，經濟部已成立「精密機械工業推動小組」，加強我國設備產業之建立，此外國內各學術單位如金屬工業中心及工研院機械所等亦積極投入相關技術之研發，提供設備廠商技術來源與資訊交流管道，金屬中心也承接經濟部工業局「光電及半導體設備產業發展計畫」，成立半導體零件測試平台，平台硬體係模擬終端商環境所建立，未來將提供真空、流場、電漿等多樣測試方法，滿足不同零組件性能測試需求，進而提升測試數據之準確性與參考價值，本公司將可藉由學術單位交流及參與政府各項獎勵及輔導優惠措施下，於 110 年獲得「行政院中堅企業獎」項肯定。

B.不利因素及因應對策

真空設備相關領域之研發人才難覓

有別於傳統之機械設備產業，真空製程設備大量使用於高科技領域之研發與生產，真空設備之技術除涵蓋傳統機械原理外，更包含物理、化學、材料、及電子等相關技術之整合，由於技術涵蓋範圍甚廣，加上產業尚處萌芽階段，無論是在資金、規模及人才均普遍不足。

因應對策

- a.結合國內外各相關研發單位，擴展研發觸角，並透過與先進國家大廠合作機會，提昇產品開發能力。

b.積極尋求上下游廠商之合作機會，以提升真空設備領域之技術。

c.積極推動國際合作機會，未來可藉由掌握先進國家在研發新產品之技術脈動，提升技術層級。

地緣政治風險提高

隨美國關稅政策，全球供應鏈移轉將成為不可避免新趨勢，全球經貿不確性提高，對於海外布局的壓力將增加。

因應對策

審慎且積極配合客戶需求，增加海外產能布局，進一步服務客戶。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

1.主要產品之重要用途

產品	主要用途
真空零組件	真空獲得的結構件，將真空零組件依照特定的方式組合之後可以利用真空泵浦排出空氣來製造真空環境，真空的作用主要是為了降低蒸鍍物的沸點，避免氣體干擾產生膜層缺陷及爭取研究膜層表面的時間，真空環境已經成為現代科技不可缺少的要素。
真空泵	利用機械、物理、化學或物理化學的方法對被抽容器進行抽氣而獲得真空的器件或設備。一般來說，真空泵是用各種方法在某一封閉空間中改善、產生和維持真空的裝置。它被大量運用半導體、光電、太陽能、機械、化工、醫療等產業。
設備清洗與再生之技術服務	針對半導體設備大廠 OLED 設備零組件之週邊需求，提供客戶超潔淨清洗及表面處理之服務。
真空設備	應用非常廣泛，包括切削刀具的硬化膜，表面裝飾鍍膜，抗電磁波輻射鍍膜，車燈反射層及保護層鍍膜，薄膜太陽能電池之背電極鍍膜，光學鍍膜以及耐磨抗蝕之功能膜等，必須由製程工藝配合適當的設備來完成鍍膜規格的要求。真空技術及真空設備在半導體產業更是扮演重要角色，舉凡半導體的四項主要製程：薄膜，蝕刻，黃光和擴散都少不了真空設備的使用，尤其半導體技術已經發展到奈米等級，真空零件和真空設備是關鍵要素。
Scrubber 設備	結合自有專利(Micro-bubble wet scrubber) 開發 Microwave Plasma Scrubber 能有效處理製程氣體全氟碳化物直接裂解、破壞與去除，效率達到 99.9%，並有效消除水中的 PFCsMicro-bubble wet scrubber，已在半導體產業業中，驗證 PM2.5 的粉塵去除率 > 95%。開發 Microwave Plasma Scrubber 設備能提供客戶更具效益及環保的尾氣處理方案，協助客戶針對氣體排放能夠符合相關法規。

2.主要產品之產製過程

- 真空元件產品如 Flange、Clamp、Center Ring、Fitting、Bellows、Valve 以及 Chamber 主要應用於真空系統之管路組裝連接，還有提供製程所需之真空環境的腔體。製造主要流程為成型、車銑、焊接、組裝、測漏及功能測試。
- 泵浦維修之流程大致分為拆解、清洗、表面處理、組裝，測試完成後再送回客戶生產線等待安裝。
- 真空設備產製過程：製程工藝及驗收標準訂定⇒架構規劃⇒細部設計⇒發包製造與採購⇒組立⇒測試⇒客戶端⇒安裝與驗收⇒售後服務。
- Micro-bubble wet scrubber 設備產製過程：製程工藝及驗收標準訂定⇒架構規劃⇒細部設計⇒發包製造與採購⇒組立⇒測試⇒客戶端⇒安裝與驗收⇒售後服務。

(三)主要原料之供應狀況

環境前言

113 年全球供應鏈持續面臨地緣政治衝突、氣候變遷與經濟復甦不均等挑戰。日揚科技作為半導體及真空設備產業的關鍵供應商，在原料供應、成本波動與市場需求變化中，透過策略性調整與數位化管理，強化供應鏈韌性並推動永續轉型。以下從三大面向說明年度營運概況：

1.主要原料分析

113 年主要原材料（如不銹鋼、鋁材、IC 晶片及電控零組件）受多重因素影響：

- (1)地緣政治與運輸風險：紅海商船襲擊事件導致航運改道，巴拿馬運河乾旱使大型船隻通行量減少 36%，推升國際運輸成本與交期不確定性。
- (2)半導體供應鏈調整：全球半導體產業歷經庫存去化週期，IC 晶片需求復甦但通路端庫存仍偏高，上游代工廠訂單回升有限，影響庫存波動。
- (3)多元化採購策略：延續既有地理分散政策，不銹鋼與鋁材主要來自臺灣、大陸、韓國及日本，並透過「期貨」鎖定價格，降低短期價格波動衝擊。

2.供應鏈穩定策略

為應對供應鏈中斷風險，公司採取以下措施：

- (1)主動式風險管理：優化「EC e-commerce」系統，整合 smart query 大數據預測工具，即時監控原料庫存與交期，建立異常警報機制，縮短決策反應時間。
- (2)多來源與近岸佈局：關鍵物料新增第二供應商，納入東、南亞（如馬來西亞、印尼、越南）近岸製造可能性，分散地緣政治風險。
- (3)強化供應商夥伴關係：與核心供應商簽訂長期協議，推動 VMI（供應商備庫）模式，確保關鍵原物料庫存穩定，同時輔導供應商遵循 ESG，如員工與碳足跡揭露。

3.成本控管與低碳轉型：

- (1)循環經濟應用：將循環設計納入產品開發，導入鋁合金陽極處理與塗層技術的九宮格色表，減少原物料浪費。

(2)ESG 合規投資：因應國際客戶要求，加速（供應鏈）減碳計畫，113 年達成無染料、塑化包材減化通過客戶認證。

(3)財務韌性強化：透過期貨合約對沖大宗商品價格風險，並優化現金流管理，113 年採購成本較預算節省 3%，支持本業毛利率回升。

結語

113 年日揚科技在動盪環境中，以「供應鏈韌性」與「永續轉型」為核心，透過數位化工具、多元採購及 ESG 整合，有效平衡成本壓力與市場需求。未來將持續深化綠色供應鏈佈局，並拓展高毛利產品線，以鞏固產業競爭優勢。

主要原料	供應來源		供應狀況
	國內	國外	
不銹鋼棒	☑		交期穩定，期貨預訂
不銹鋼板	☑	☑	交期穩定，期貨預訂
不銹鋼無縫管	☑	☑	交期穩定，年單預訂
不銹鋼軟管	☑	☑	交期穩定，年單預訂
電控材料	☑	☑	交期穩定，VMI 因應
機械市購件	☑	☑	交期穩定，BP 因應
機械加工件	☑		交期穩定，BP 因應

※Blanket order:無交訂單

(四)主要進銷貨客戶

1.最近二年度任一年度曾占進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例

單位：新台幣千元

項目	112年度				113年度			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率%	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率%	與發行人之關係
1	甲公司	226,566	12%	無	甲公司	168,497	9%	無
2	乙公司	198,829	10%	無	乙公司	164,200	8%	無
3	其他	1,517,998	78%	-	其他	1,658,820	83%	-
4	進貨淨額	1,943,393	100%	-	進貨淨額	1,991,517	100%	-

增減變動原因說明：進貨金額與比例變動主要係因產品需求變動所致。

2.最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例

單位：新台幣千元

項目	112年度				113年度			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率%	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率%	與發行人之關係
1	A 公司	772,851	18%	無	A 公司	851,855	22%	無
2	其他	3,432,585	82%	-	其他	3,082,412	78%	-
3	銷貨淨額	4,205,436	100%	-	銷貨淨額	3,934,267	100%	-

增減變動原因說明：最近二年度占銷貨總額百分之十以上之客戶並無變動。

三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率

單位：人

年度		112 年度	113 年度	當年度截至 114 年 4 月 8 日
員 工 人 數	直接人工	376	365	342
	間接人工	485	482	496
	合計	861	847	838
平均年歲		38	39	39
平均服務年資		6	6	7
學 歷 分 布 比 率	博士	1%	1%	1%
	碩士	8%	11%	11%
	大專	64%	66%	66%
	高中	19%	16%	16%
	高中以下	8%	6%	6%

四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失(包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：

處分日期：113 年 11 月 19 日、處分字號：環水毒裁字第 113110022 號、違反法規條文：違反毒性及關注化學物質管理法第 25 條第 3 項暨毒性及關注化學物質許可登記核可管理辦法第 7 條第 2 項規定、違反法規內容：負責人變更核發日期為 113 年 6 月 27 日，申請變更負責人為 113 年 9 月 6 日，未依毒性及關注化學物質許可登記核可管理辦法第 7 條第 2 項規定，於 60 日內完成負責人變更、處分內容：罰鍰新台幣三萬元整，處環境講習 2 小時。

因應措施：未來如有變更或異動，第一時間查詢相關法規並詢問當地主管機關，並提前於規定期限內完成申請。

公司通過 ISO 14001 驗證，每半年進行內部稽核，每年進行外部驗證公司查核，除遵循環保法規委託合法廢棄物清除處理廠商，並安排年度稽核確認其運作情形。

另針對環保相關法規，定期進行審視查核，相關防制設備落實自動檢查與維護保養，預計未來應無污染環境所遭受之重大損失事件發生。

五、勞資關係

(一)各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

1.多元且優於法規之福利措施

獎金及補助	保險及家庭友善
1. 年終獎金 2. 員工紅利 3. 績效獎金 4. 銷售獎金 5. 提案改善獎金 6. 效率改善獎金 7. 三節獎金/禮品 8. 勞動節獎金/禮品 9. 員工持股信託補助 10. 旅遊補助	1. 勞、健保及提繳退休金 2. 優渥且完整的員工團保及定期壽險 3. 眷屬團保 4. 意外險 5. 職災保險 6. 兒童照顧假 7. 彈性工時

- 公司為員工及眷屬辦理勞保、健保、員工壽險、團體保險及職災保險，對於經常國外出差員工另有加保旅行平安險，創造員工無後顧之憂的工作環境。
- 制定績效獎金、持股信託入股、員工酬勞、業績獎金等獎勵管理制度，視團隊經營績效及個人考核結果發放獎金分享經營績效。
- 設置員工宿舍及特約旅館，照顧遠道及出差的員工。
- 設置母性哺集乳室，照顧分娩後之員工，進行哺集乳使用，持續營造親善哺乳環境。
- 舉行員工家庭日，不僅加強員工關係，更強化與員工家庭間之情感連結。
- 協助員工辦理往來行庫員工低利貸款，為員工謀求成本較低之資金運用。
- 成立福利委員會，按創立實收資本額之 1%、每月銷貨收入之 0.15%及下腳收入之 40%，提撥為職工福利金;提供年節禮品(禮金)、生日、婚喪致意、尾牙活動，員工國內外旅遊、社團活動等福利措施，加強勞資和諧關係。
- 上海日揚公司依中國區社會保險有關法令，為全體在職員工辦理上海市城鎮保險及商業保險，創造員工無後顧之憂的工作環境。

2.員工進修及訓練

為鼓勵員工於工作中持續學習與進修，活到老學到老，公司安排以下分類之訓練課程：

- 新進人員訓練：含工業安全衛生、基礎管理制度及單位專業技能等訓練，俾使新進人能儘早熟悉單位及公司運作並預防意外災害; 113 年度共 104 員新進人員參加訓練，合計受訓時數 2,549 小時。
- 職能訓練：以外訓為主、外聘或內部講師內訓為輔，以使各職務別人員得以精益求精、強化專業職能; 113 年度共 244 人次參加外部訓練，合計受訓時數 2,003 小時; 8,682 人次參加內部訓練，合計受訓時數 13,549 小時。

3.退休制度及其實施情形

- 自 94 年 7 月 1 日起，員工選擇適用「勞工退休金條例」之退休金制度者，按其每月薪資等級提撥 6%至勞工保險局之員工個人退休金專戶，以備新制年資員工退休之需。
- 公司優於法令，另外訂立員工持股信託管理辦法，用於吸引優秀人才提供公司向心力以及希冀員工能於急難或退休時，有利於自身退休生活之運用。
- 本公司員工參加持股信託情形彙總如下：

項目	111/12	112/12	113/12
參加持股信託人數	255	298	320

4.勞資間協議與各項員工權益維護措施情形

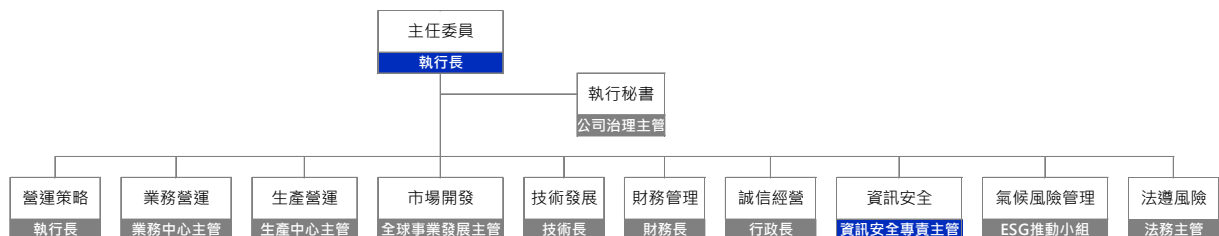
日揚公司屬「勞動基準法」適用行業，一切運作均以勞基法為遵循基準。公司建立完善之提案制度，受理員工對工作流程、管理制度改善、員工意見投訴廣徵員工各方意見，以做為公司各項措施改善之參考。由於平時即重視員工各項福利及與員工之雙向溝通，因此勞資關係尚稱和諧，自創立以來均未發生勞資糾紛事件，惟公司仍持續加強勞資雙方之溝通協調，並盡力做好福利措施，促使勞資關係更加和諧，以期消弭勞資糾紛發生之可能。113 年度及截至刊印日止無勞資爭議產生。

(二)最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失（包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施

- 1.日揚公司自成立至今，勞資關係和諧，最近年度及截至年報刊印日止並無發生因勞資糾紛而導致損失之情事。
- 2.目前及未來可能發生損失：公司重視員工意見，深入瞭解員工對管理與福利制度之滿意度，持續維持良好的勞資關係。因勞資關係良好，勞方與資方達成共識，故無勞資糾紛發生及遭受相關損失。
- 3.因應對策：隨時與員工保持良好之溝通管道，以避免發生勞資糾紛。

六、資通安全管理

(一)資訊安全管理架構



本公司目前由資訊部負責資通安全推動，現行資訊管理系統依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第九條設置內部控制 EDP 作業制度執行，各項控制作業以 ISO 27001、個人資料保護法施行細則、上市上櫃公司資通安全管控指引為參考作業標準，並由資訊單位依組織部門職責負責統籌資訊安全及相關事宜，依據實際管理需求制訂資

安政策、訂定管理辦法及策推動與落實。稽核單位依內部控制程序進行內部稽核，定期追蹤改善結果，以降低資安風險。

本公司於 111/11/10 設置風險管理委員會，由執行長擔任主任委員，並建立資訊風險小組，為資訊安全專責管理單位，於 113 年將資安小組整合入策略委員會，設置 1 位資訊安全專責主管及 1 位資訊安全專責人員，並定期每年至少一次向董事會報告資通安全管理執行情形。

(二)資訊安全政策

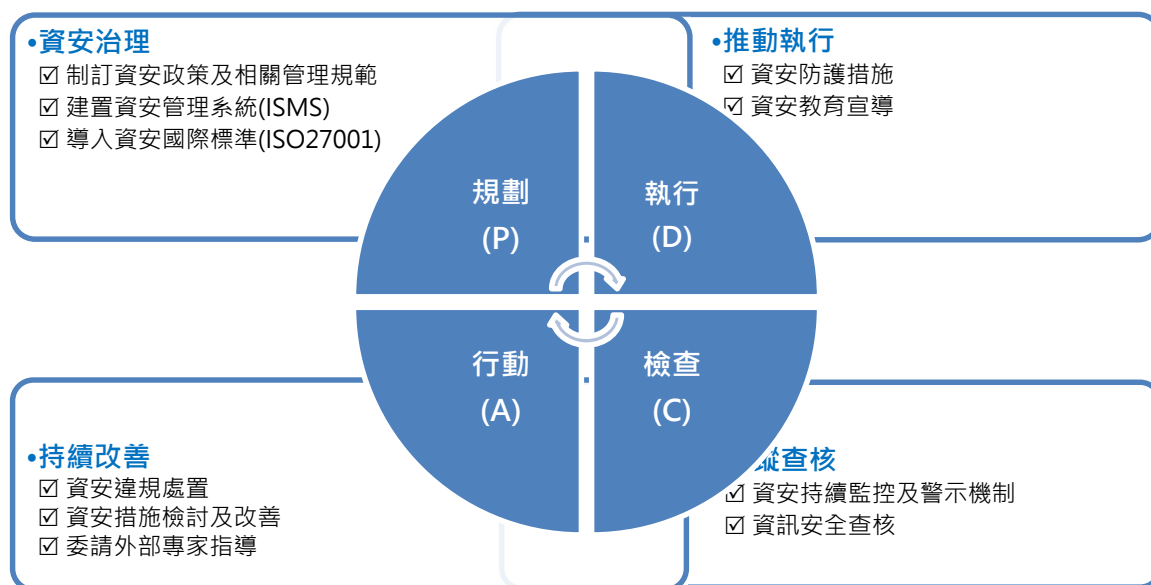
為強化資訊安全，確保所屬之資訊資產的機密性、完整性、可用性與個人資料之要求，以提供本公司之資訊業務持續運作之資訊環境，並符合相關法令、法規之要求，使其免於遭受內、外部蓄意或意外之威脅，本公司於 111/9/12 制定「資訊安全政策管理辦法」，提供公司全體同仁共同遵循。

為維護本公司資訊資產之機密性、完整性與可用性，並保障使用者資料隱私之安全。期藉由本公司全體同仁共同努力以達成下列目標：

- 1.保護本公司營運活動資訊，避免未經授權的存取，以確保其機密性。
- 2.保護本公司營運活動資訊，避免未經授權的修改，以確保其正確性與完整性。
- 3.制訂、推動、實施及評估改進資訊安全管理事項，確保本公司具備可供營運持續運作之資訊環境。
- 4.辦理資訊安全教育訓練，推廣資訊安全之意識與強化其對相關責任之認知。
- 5.執行資訊安全風險評估機制，提升資訊安全管理之有效性與即時性。
- 6.實施資訊安全內部稽核制度，確保資訊安全管理之落實執行。
- 7.建立本公司營運持續運作計畫，以確保本公司營運服務之持續運作。
- 8.本公司之各項營運活動執行須符合相關法令或法規之要求。

(三)資訊安全管理方案

為增進本公司資訊安全及穩定之運作，提供可信賴之資訊服務，確保資訊系統之機密性、完整性及可用性，提升用戶端資安意識，實行各項管理作業



管理事項	作業說明
1.資訊資產之安全管理	☒ 資產清冊每年定期盤點。 ☒ 重要資產簽訂更新維護保固作業。 ☒ 重要系統及資料進行本地備份、異地備分或雲端備份機制。
2.人員管理及教育訓練	☒ 持續建立、宣導及推廣員工資訊安全認知以提升資訊安全 ☒ 新進同仁資訊安全宣導訓練。 ☒ 不定期各類資訊安全宣導。
3.實體及環境安全管理	☒ 資訊機房安全區域設置有門禁控制，確保只有經過授權人員才許可進入。 ☒ 資訊相關設備，應適當地進行安置、保護、監控，以降低環境威脅所造成的損害，例如環境溫溼度監控。
4.電腦系統及網路安全管理	☒ 外部及個人電腦網路設備不得私自連接公司網路。 ☒ 企業級無線網路系統，經系統整合驗證機制始能連線。 ☒ 重要資料採檔案加密保護機制。 ☒ 使用專業防毒軟體，並自動更新。 ☒ 設置新世代網路防火牆，設定連線規則，確保使用安全。 ☒ 郵件系統垃圾郵件過戶、病毒威脅防護及主機電腦弱點掃描及重大修補程式更新。
5.系統存取控制安全	☒ 系統權限依員工職務職能以經權限申請作業後存取。 ☒ 每年定期進行權限覆核作業。 ☒ 設置密碼、鎖定及複雜度等原則。
6.系統發展、開發及維護之安全管理	☒ 自行開發或委外發展系統，需將資訊安全需求納入考量；系統之維護、更新、上線執行及版本異動作業，避免不當危害風險。
7.營運持續運作	☒ 每年依公司營運持續計畫進行風險評估及災難復原演練規劃，並依計畫進行系統災難復原演練，確保資訊系統之可用性。

(四)投入資通訊安全管理資源及執行情形

為增進本公司資訊安全及穩定之運作，提供可信賴之資訊服務，確保資訊系統之機密性、完整性及可用性，提升用戶端資安意識，實行各項管理作業。目前資訊部設置8位人力，負責資訊管理制度、全體公司資訊系統、軟硬體建置，113年各項資安管理作業執行狀況如下：

項目	113年執行情形
內部全員資安宣導	☒ 內部 EIP 公告發布全員資安宣導： ① 網路釣魚陷阱 (113/3/27) ② 詐騙郵件提醒 (113/7/26) ③ AI軟體與服務可能產生之風險疑慮 (113/10/23) ☒ 新進人員資訊安全宣導。 ☒ 電子看板常態性資訊安全宣導。 ☒ ISO27001 教育訓練。

項目	113年執行情形		
查核作業	資通安全檢查作業查核 (113/1月)		
資安演練	備份系統還原演練 (每年至少一次)		
聯防組織	經申請核可為TWCERT資安聯盟會員 (111年已加入)		
資安會議	113年共召開4次資安小組會議，其重點事項： ☒ 資安風險盤點與監控、建立風險評鑑工作表 (113/1/24) ☒ 外部系統導入資安風險評估 (113/4/17、113/8/6) ☒ 建立資安架構圖與事件處理流程、第三方資安風險評級 (113/7/3)		
資安人員 教育訓練	日期	課程名稱/證書	時數,人數
	113/3/29	SRAMT資訊安全分析實務-方法、流程與工具	35小時,1人
	113/5/8	第三方委外與供應鏈資安管理	3小時,1人
	113/6/25	資訊風險評鑑與風險處理	3小時,1人
	113/9/27	NSPA 網路安全封包分析	21小時,1人
	113/10/9	CompTIA Security+ 國際網路資安認證班	40小時,1人

(六)列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施

資安指標	資安客訴事件	外部破壞、竊取資料 或病毒威脅事件	資訊系統異常或設備 異常影響營運事件
113年事件統計(件)	0件	0件	0件

七、重要契約

截至年報刊印日止，除一般商業交易行為外，本公司目前並無簽訂重要契約。另本公司於合併財務報告亦揭露「重大或有負債及未認列之合約承諾」。

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

單位：新台幣千元

項目 \ 年度	112 年度	113 年度	差異	
			金額	%
流動資產	3,438,142	3,919,126	480,984	14
不動產、廠房及設備	3,307,794	3,476,393	168,599	5
無形資產	103,966	97,735	(6,231)	(6)
其他資產	426,974	463,151	36,177	8
資產總額	7,276,876	7,956,405	679,529	9
流動負債	2,239,217	2,071,412	(167,805)	(7)
非流動負債	1,470,225	1,950,797	480,572	33
負債總額	3,709,442	4,022,209	312,767	8
股本	1,182,017	945,613	(236,404)	(20)
資本公積	361,290	410,684	49,394	14
保留盈餘	1,415,679	1,738,998	323,319	23
其他權益	(41,451)	(7,270)	34,181	82
歸屬於母公司業主之權益	2,917,535	3,088,025	170,490	6
非控制權益	649,899	846,171	196,272	30
股東權益總額	3,567,434	3,934,196	366,762	10
增減比例變動分析說明(變動比例達 20%且金額達 1 千萬元以上)：				
1.非流動負債增加主係長期借款增加所致。				
2.股本減少係本公司現金減資所致。				
3.其他權益增加主係國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加所致。				

二、財務績效

(一)最近二年度經營結果比較分析

單位：新台幣千元

項目	112 年度	113 年度	增(減)金額	變動比例%
營業收入	4,205,436	3,934,267	(271,169)	(6)
營業毛利	1,437,541	1,359,804	(77,737)	(5)
營業利益	550,775	454,276	(96,499)	(18)
營業外收入及支出	(27,139)	(5,384)	21,755	80
稅前淨利(淨損)	523,636	448,892	(74,744)	(14)
本期淨利(淨損)	418,227	385,874	(32,353)	(8)
其他綜合損益(稅後淨額)	(16,012)	37,447	53,459	334
本期綜合損益總額	402,215	423,321	21,106	5
增減比例變動分析說明(變動比例達 20%且金額達 1 千萬元以上)：				
1.營業外收入及支出增加主係採權益法認列之關聯企業利益及外幣兌換利益增加所致。				
2.其他綜合損益(稅後淨額)增加主係國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加所致。				

(二)預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫

本公司依據產業環境及市場未來供需狀況並考量研發計畫、業務發展情形等相關資訊作評估，訂定年度銷售目標，本公司所屬行業仍屬成長階段，未來將視市場需求變動狀況，擴大市場占有率，提升公司獲利能力。

三、現金流量

(一)最近年度現金流量變動之分析說明

單位：新台幣千元

期初現金 餘額	全年來自營業 活動淨現金流量	全年現金 流入(出)量	現金剩餘數額	現金不足額之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
821,990	533,870	(123,732)	1,232,128	無	無

113 年度現金流量變動分析說明如下：

- 1.營業活動現金流入 533,870 千元：主要係自於營業收入。
- 2.投資及融資活動現金流出 123,732 千元：主要係購入設備及償還銀行借款。

(二)流動性不足之改善計畫：本公司無現金不足情形。

(三)未來一年現金流動性分析

單位：新台幣千元

期初現金 餘額	預計全年來自營 業活動淨現金流量	預計全年現 金流出量	預計現金剩 餘數額	預計現金不足額之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
1,232,128	337,419	(298,625)	1,270,922	無	無

1.未來一年度現金流量變動情形分析：

- (1)營業活動淨現金流入主要來自於營業收現流入。
- (2)投資及融資活動現金流出主要用於償還長期借款、資本支出等。

2.預計現金不足額之補救措施及流動性分析：

本公司未來一年預估之現金流出主要係因應未來營運需求，除以營運活動現金流入支應外，於現金餘額不足時，將以銀行借款或現金籌資因應。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

(一)最近年度轉投資政策

結合與真空技術相關之垂直及上下游產業，積極進行策略合作或併購計畫，共同發展成為策略合作夥伴，獲取相關產業資訊，深入了解真空製程設備應用領域為主，創造營收及獲利新高。

(二)轉投資獲利或虧損之主要原因、改善計畫

本公司 113 年度採權益法認列之投資利益為新台幣 111,775 千元，主要係轉投資公司營運狀況穩定，持續獲利所致。

(三)未來一年投資計畫

本公司將以策略性並兼具未來生長性角度評估任何投資計畫，以因應未來市場及景氣的變化。

六、風險管理分析評估

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

1.利率

因本公司內之個體以浮動利率進行資金管理，因而產生利率暴險。本公司於資產負債表日受利率暴險之金融資產及金融負債帳面金額如下

單位：新台幣千元

項目	113 年度
利息收(支)淨額	(34,837)
占營業收入比例	(0.89%)
占本期淨利比例	(9.03%)
具現金流量利率風險：	
金融資產	1,201,064
金融負債	2,783,286

若利率增加 1%，在所有其他變數維持不變之情況下，本公司 113 年度之稅前淨利將減少 15,822 千元。

因應措施：本公司為規避利率變動之影響，除隨時注意市場利率變化之趨勢外，定期評估金融機構借款利率，同時取得市場平均利率，並與金融機構密切聯繫以極力爭取最優惠的借款利率。

2.匯率

單位：新台幣千元

項目	113 年度
兌換(損)益淨額	24,114
占營業收入比例	0.61%
占本期淨利比例	6.25%

本公司外幣支應係從事外幣計價之外銷貨物及進口原物料所產生，匯率曝險管理係於內部控制制度及相關管理辦法許可之範圍內，利用遠期外匯合約管理風險。

本公司於資產負債表日非功能性貨幣計價之貨幣性資產與貨幣性負債帳面金額如下表

單位：新台幣千元

項目	113 年度
貨幣性項目：	
金融資產	288,791
金融負債	25,852

外幣淨部位主要受美元及日圓匯率波動之影響，當各攸關外幣對新台幣之匯率變動時，若外幣升值 1%，本公司 113 年度稅前淨利將增加 2,630 千元。

因應措施：本公司外匯管理係採穩健保守之方式，以減少市場匯率大幅波動所造成之風險，因應匯率變動之具體措施主要如下

- (1)利用資產負債相對部位，以自然避險方式消除部分匯兌波動之風險。
- (2)隨時蒐集有關匯率變化資訊，充分掌握匯率走勢，以決定轉換新台幣之時點。
- (3)善用國內外匯兌避險操作工具，以規避因匯率變動所造成之匯兌損失。

3.通貨膨脹情形對本公司損益之影響及未來因應措施

近期隨著國內外價格持續上漲，物價波動大，預期物價將有上漲之趨勢，本公司將密切注意通貨膨脹情形，適當調整產品售價及原物料庫存量，以降低通貨膨脹對本公司造成之影響，並對於主要原料與合作廠商簽訂長期採購合約以穩定價格。

(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

1.本公司基於穩健保守原則，最近年度及截至年報刊印日止，無從事高風險、高槓桿投資。

2.資金貸與他人

本公司訂有「資金貸與他人作業程序」，作為資金貸與他人之依據，最近年度及截至年報刊印日止，無資金貸與他人情形。

3.背書保證

113 年 12 月 31 日；單位：新台幣千元

背書保證者	被背書保證對象	與本公司 關係	持股率	期末背書 保證餘額
日揚科技股份有限公司	HIGHLIGHT TECH JAPAN Co., Ltd	註 1	100%	83,960
日揚科技股份有限公司	利梭貿易股份有限公司	註 1	100%	30,000

註 1：母公司與子公司持有普通股股權合併計算超過 50%之被投資公司。

背書保證主要目的為因應轉投資公司之營運資金需求，相關政策執行除審慎評估、定期回報及控管外，以本公司之「背書保證作業程序」及董事會決議為依據。

4.衍生性商品交易

本公司基於規避外幣債權及債務因匯率變動產生之風險從事衍生性金融商品交易，其交易政策係以達成規避大部分公平價值變動或現金流量風險為目的。

截至 113 年底止，本公司從事遠期外匯無未到期之合約。

本公司從事衍生性商品之操作係以規避外幣資產及負債因匯率波動產生之風險為目的，加以本公司之「取得或處分資產處理程序」對此交易均有嚴格規範，故所產生之獲利或虧損對本公司之損益並未造成重大影響，而未來的操作仍以規避風險為目的。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用

1.未來研發計畫

項次	項目	研發計畫	目前研發進度
一	敏捷反應智慧控壓蝶閥開發專案	1.電流調控系統/驅動板設計。 2.自適應演算法。 3.硬體電路開發及軟韌體開發。 4.產業應用：面板半導體產業之 PVD, CVD 真空設備。	1.專案規劃。 2.驅動板韌體初版設計。 3.控制算法初版架構設計。 4.虛擬環境演算設計。
二	CF200/ISO250/ISO320 側掛型閘閥專案	1.確認技術規格、測試執行以確保產品功能要求，同時清楚訂定作業標準書及產品說明書，開發系列化產品(CF200/ISO250)。 2.產業應用：面板半導體產業之 PVD, CVD 真空設備。	1.完成 CF200/ISO250 設計圖、規格書。 2.完成 CF200 規格測試驗證。 3.ISO250 規格組裝測試驗證中。
三	50x336 & 46x236 二段氣壓式 Read L-motion 矩形閥開發專案	1.減少粒子生成的二段汽缸驅動 L-Motion 的技術。 2.T bar 與 Bellows 軸密封技術開發。 3.創造平滑且低衝擊的運動連貫技術並同時支援斷氣電安全保護。 4.產業應用：面板半導體產業之 PVD, CVD 真空設備。	1.完成開發計畫書與相關專利解析和結構設計解析。 2.時序邏輯氣路閥 PID 設計分析及構思。 3.閘板及壓杆設計結構構思。
四	ISO250/320 低氣導 APC 鐘擺閥開發專案	1.自動壓力控制、軟韌體程式開發、PCB 電路設計、電動驅動技術開發。 2.可承受高工作溫度 150 °C 的技術與相容於多種通訊規格技術。 3.產業應用：面板半導體產業之 PVD, CVD 真空設備。	1.完成開發計畫書、相關專利解析和閥門初步設計結構圖。 2.完成 Gate plate 低氣導 gap 結構構思。 3.驅動機構設計及馬達扭力計算。
五	低 Particle Door valve 專案	1.藉由有效減少氣體或系統運行過程中的微小顆粒(如灰塵、污染物等)，從而避免粉塵沾附影響製程良率和生產效率。 2.完成規格確認、測試規劃並制定產品標準文件。 3.產業應用：面板半導體產業之 PVD, CVD 真空設備。	1.完成設計圖、規格書。 2.完成初始組裝功能驗證。 3.組裝 SOP 等專案文件建立。 4.目前針對設計優化改善進行。
六	CF35&CF63 all-metal GV 關鍵模組提升專案	1.高潔淨清洗技術+Hard to Hard 的封合技術+高溫可烘烤汽缸技術+射頻屏蔽客製化技術。 2.完成規格確認、測試規劃並制定產品標準文件。 3.產業應用：極限真空設備應用，為同步輻射加速器設備關鍵閥門。	1.完成高壽命碟盤設計參數。 2.完成 DISC 均勻度測試設備與量測方法與均勻度測試。 3.完成 Ag 鍍層試片材料厚度最佳化。 4.完成耐高溫氣缸設計及測試驗證。

項次	項目	研發計畫	目前研發進度
七	Dry Rotor 開發計畫	1.自主生產重要零組件，解決廠內維修需求，同時依市場需求開發轉子及各項零組件販售。 2.研發&加工技術建立。 3.與外界學術單位共同合作，從基礎理論進行設計研究。 4.與國內加工大廠合作轉子加工，同時吸取經驗提升廠內技術。	1.轉子一已於 113/3 月上機測試中。 2.轉子二及轉子三，已安排上機測試。 3.轉子四及轉子五製作開發中。
八	TMP Rotor 開發計畫	1.自主生產重要零組件，解決廠內維修需求，同時因應市場需求開發轉子及各項零組件販售。 2.研發&加工技術建立。	已完成縮短機械加工 1/3 的時程。
九	WEH® 塗佈技術開發	以提高 WEH® 塗佈再現性為目標，進行機器塗佈的流程開發與鍍膜參數研究。	1.可控制噴塗厚度 3-8um。 2.WEH® coating 之管件與閥門 SOP 撰寫中。
十	晶圓化製程設備與代工	完成 SiC 6" /8" 商業化的生產線(含切/磨/拋/檢測)、標準檢測流程 (對於每一單站進行 IQC 及 OQC)和晶圓產品規格。	6" 切/磨/拋/檢測初步驗證結果符合市售規格 RPS 初步驗證能改善基板表面粗糙度。
十一	自動化 SAM 與 XRT 線上檢測與影像處理技術	1.完成自動化 SAM 檢測設備的開發及影像處理技術，並針對訊號擷取模組進行優化，開發出雜訊排除技術。 2.實現多層影像分離技術與瑕疵影像分析，並開發出可檢測 4 至 8 英寸晶錠及晶圓的 XRT 檢測設備。 3.進行了系統整合，並通過測試和影像優化，進一步完善了瑕疵影像分類技術。 4.模擬與建立實驗平台、以達精準量測訴求。	1.SAM 對 6" 基板樣品次損傷層檢測分析與建立分級機制。 2.XRT 對 6" 晶錠樣品缺陷檢測及建立篩選機制。 3.執行調平機構和軸控平台觸發訊號測試。
十二	DIO3 溼式晶圓(面板)清洗設備與製程開發	1.完成 12" 自動化單晶圓清洗設備之整合與驗證。 2.依據客戶之需求進行 DIO3 整合製程驗證。	完成單晶圓清洗光阻參數調校與驗證。
十三	低震動矩形閥/氣動氣缸控制閥門	1.低震動矩形閥 (1)運動控制演算法導入。 (2)低震動閥門控制模組整合與推廣。 2.氣動氣缸控制閥門 (1)氣動元件選用。 (2)氣動氣缸控制技術。 (3)閥門產品整合。 (4)系統開發。	1.低震動矩形閥，控制演算法初版功能確認，並已針對額外功能與初版修改方向提出需求。 2.氣動氣缸控制閥門，已完成氣動元件氣缸控制技術驗證，並規劃進行與全金屬閥門產品整合之技術開發驗證項目。

項次	項目	研發計畫	目前研發進度
十四	SCMS 智能尾氣系統	1.CIU 輕量化訊號擷取方案。 2.Pump 壽命預測模型整合及測試。 3.應內外部需求開發 SCMS 2.0 平台。	建立之 SCMS 2.0 平台具備自行開發彈性，且可移轉至不同系統。
十五	半導體設備開發、客製、維護	MRC SECS/GEM 模組開發，交機外功能開發以及新閥門 UI 控制。	1.完成 SECS/GEM 初步通訊，規劃進行測試驗證。 2.探討 MRC 其它通訊方式並規劃測試。

2.本公司預計投入之研發費用:114 年度之研發經費預估為新臺幣 1.2 億元至 1.3 億元。

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

本公司持續注意可能影響公司營運的政策及法令之變動，並因應主管機關對公司治理、公司法等修訂，本公司業已配合辦理，目前對財務業務尚無重大影響，且最近年度並未因國內外重要政策及法律變動而對公司財務業務產生重大影響。

(五)科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

本公司除搜尋產業相關訊息，亦不定期進行檢討外部產業變化對公司之影響及策略之擬定、方向修正，財務、業務及公司內部相關單位皆隨時掌握外部產業變化情形。如變化將導致公司暴露於風險中，本公司亦即隨時召集內部會議進行討論因應之，除落實資訊安全政策並對內加強人員資安教育宣導以降低資通安全風險外，並持續開發新技術、拓展新市場及新產業，讓公司走在最前端，致真空應用服務領域上能持續維持領先地位，讓外部變化對公司之損失降到最低。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司秉持者穩健踏實之原則，企業形象良好，不定期持續針對弱勢團體提供物資、金錢捐贈...等協助，並藉由進入資本市場，吸引更多優秀人才進入本公司服務，厚植經營團隊實力，再將經營成果回饋股東大眾，盡企業應有之社會責任，因此並無危及企業形象之情事發生，且無產生企業危機之風險。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施

截至年報刊印日止，本公司尚無重大併購計畫，如果因經濟環境及集團整體規劃有所改變，有關併購計畫將依法令規定進行。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

擴充廠房可使本公司提升生產能力以承接更多的客戶訂單，進而有機會擴大市場佔有率。然而半導體產業之景氣循環起伏甚大，當景氣下滑市場需求減少時，產生閒置產能仍需提列廠房設備之折舊，此種風險將會成為公司的負擔之一。本公司產能之擴充皆經過縝密之資本支出規劃，力求滿足客戶需求之同時，亦將資本之利用最佳化以求產業之健康發展。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

本公司供應鏈管理穩健，已與國內外多家供應商建立長期穩定的合作關係，確保原物料與關鍵零組件的穩定供應，故最近年度及截止年報刊印日止並無供貨短缺或中斷之情形，供貨狀況尚屬良好。透過持續強化議價能力、優化採購策略及生產流程，公司有效控制成本並提升生產效率。此外，為進一步提升競爭力，公司正展開與更多優質供應商建立合作，並導入自動化技術，以增強成本優勢與生產彈性。

在銷售方面，公司擁有多元化的客戶群，並與主要客戶維持良好的合作關係。儘管市場競爭激烈，公司持續拓展業務版圖，並透過提供高品質產品與客製化解決方案，提升客戶滿意度與忠誠度。同時，公司積極開發新市場與國際合作夥伴，以擴大市場佔有率，降低單一市場或客戶依賴的風險。未來，公司將進一步優化交期管理、強化供應鏈靈活性，確保能夠快速回應市場需求，並在穩健經營的基礎上持續成長。

(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施

最近年度及截至年報刊印日止，本公司董事無股權大量移轉或大幅更換之情事；公司無持股超過 10%之大股東。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施

本公司最近年度及截至年報刊印日止，未有經營權改變之情事。

(十二)訴訟或非訟事件

公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：

本公司最近年度及截至年報刊印日止，無繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件。

(十三)其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一)關係企業合併營業報告書

最近年度之關係企業合併營業報告書業已於主管機關指定之資訊申報網站中申報，資訊查詢之入徑及網址如下列示

●查詢入徑：公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區

●查詢網址：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10

(二)關係報告書：不適用

(三)關係企業合併財務報表

依金融監督管理委員會民國 113 年 6 月 26 日金管證審字第 1130382569 號函，本公司依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司，與依國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中已揭露，故無另行編製關係企業合併財務報表。最近年度之財務報表已於主管機關指定之資訊申報網站中申報，資訊查詢之入徑及網址如下列示

●查詢入徑：公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>財務報告書

●查詢網址：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t57sb01_q1

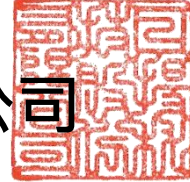
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無此情形。

三、其他必要補充說明事項：無。

四、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第 36 條第 3 項第 2 款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項

本公司為提升股東權益報酬率及調整資本結構，經 113 年 6 月 7 日股東會決議通過辦理現金減資退還部分股款予股東。現金減資金額為新台幣 236,403,360 元整，消除股份 23,640,336 股，減資比率 20%，減資後實收資本額為新台幣 945,613,430 元，發行股數為 94,561,343 股。該案已於 113 年 8 月 12 日完成變更登記。

日揚科技股份有限公司



董事長 吳昇憲





日揚科技
HIGHLIGHT TECH CORP.

